

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Akihiro MURATA

Application No.: 09/800,483

Filed: March 8, 2001

Docket No.: 108883

PLATFORM AND OPTICAL MODULE, MANUFACTURING METHOD OF THE SAME,
AND OPTICAL TRANSMISSION DEVICE

CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2000-106401 filed April 7, 2000.

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

 X is filed herewith.

 was filed on in Parent Application No. filed .

 will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,



James A. Oliff
Registration No. 27,075

Thomas J. Pardini
Registration No. 30,411

JAO:TJP/kaf

Date: July 16, 2001

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

DEPOSIT ACCOUNT USE
AUTHORIZATION
Please grant any extension
necessary for entry;
Charge any fee due to our
Deposit Account No. 15-0461



日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2 0 0 0 年 4 月 7 日

出 願 番 号
Application Number:

特願 2 0 0 0 - 1 0 6 4 0 1

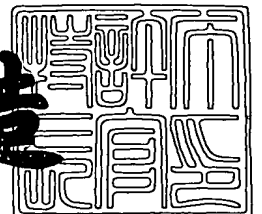
出 願 人
Applicant (s):

セイコーエプソン株式会社

2 0 0 1 年 3 月 1 6 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特 2 0 0 1 - 3 0 2 0 4 5 5

【書類名】 特許願

【整理番号】 EP-0229901

【提出日】 平成12年 4月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 6/24

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 村田 昭浩

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090479

【弁理士】

【氏名又は名称】 井上 一

【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】 100090387

【弁理士】

【氏名又は名称】 布施 行夫

【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】 100090398

【弁理士】

【氏名又は名称】 大淵 美千栄

【電話番号】 03-5397-0891

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039491

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9402500

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プラットフォーム及び光モジュール並びにこれらの製造方法並びに光伝達装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 及び第 2 の領域を有する型に、配線を前記第 1 又は第 2 の領域に付着させて設け、

ピンを、前記ピンの先端部を前記型に向けて配置し、

成形材料で前記配線及び前記ピンを封止し、

前記ピンを前記成形材料から抜いて前記成形材料に貫通穴を形成し、前記配線及び前記成形材料を前記型から剥離する工程を含むプラットフォームの製造方法

【請求項 2】 請求項 1 記載のプラットフォームの製造方法において、
前記配線はワイヤからなり、前記ワイヤの両端部を前記第 1 及び第 2 の領域にボンディングするプラットフォームの製造方法。

【請求項 3】 請求項 2 記載のプラットフォームの製造方法において、
予め前記ボンディングパッドを形成し、前記ボンディングパッドに前記ワイヤをボンディングするプラットフォームの製造方法。

【請求項 4】 請求項 1 記載のプラットフォームの製造方法において、
前記配線は導電層からなり、前記導電層を前記第 1 及び第 2 の領域に形成するプラットフォームの形成方法。

【請求項 5】 請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載のプラットフォームの製造方法において、

前記型及び前記ピンの少なくとも一方に離型剤を塗布した状態で、前記成形材料により前記配線及び前記ピンを封止するプラットフォームの製造方法。

【請求項 6】 請求項 1 から請求項 5 のいずれかに記載のプラットフォームの製造方法において、

前記ピンの先端部を前記型に形成された穴に挿入するプラットフォームの製造方法。

【請求項 7】 請求項 6 記載のプラットフォームの製造方法において、
前記型の前記第 1 の領域は、ほぼ平坦に形成されてなり、
前記穴は、前記第 1 の領域に形成されてなるプラットフォームの製造方法。

【請求項 8】 請求項 6 記載のプラットフォームの製造方法において、
前記型は、前記第 1 の領域に凸部を有し、前記凸部の上端面に前記穴が設けられてなるプラットフォームの製造方法。

【請求項 9】 請求項 1 から請求項 8 のいずれかに記載のプラットフォームの製造方法において、

前記型は、前記第 1 の領域が前記第 2 の領域よりも突出して形成されてなり、
前記成形材料に、前記型の形状に対応して窪みを形成するプラットフォームの製造方法。

【請求項 1 0】 請求項 1 から請求項 9 のいずれかに記載のプラットフォームの製造方法において、

前記型は、突起を有し、前記突起が設けられた領域に前記配線を付着させ、
前記成形材料に凹部を形成するプラットフォームの製造方法。

【請求項 1 1】 請求項 1 0 記載のプラットフォームの製造方法において、
前記凹部に導電材料を充填する工程をさらに含むプラットフォームの製造方法

【請求項 1 2】 請求項 1 から請求項 1 1 のいずれかに記載のプラットフォームの製造方法において、

前記型に、前記配線と電氣的に接続させて電子部品を搭載し、
前記成形材料で、前記配線とともに前記電子部品を封止するプラットフォームの製造方法。

【請求項 1 3】 請求項 1 から請求項 1 2 のいずれかに記載のプラットフォームの製造方法において、

前記型は、前記第 1 の領域と、前記第 1 の領域より低い位置に設けられる第 2 の領域と、前記第 1 及び第 2 の領域の間に設けられる第 3 の領域と、を有し、

前記配線を設ける工程では、配線を第 1 又は第 2 の領域と、第 3 の領域とに付着させるプラットフォームの製造方法。

【請求項 1 4】 請求項 1 から請求項 1 3 のいずれかに記載のプラットフォームの製造方法において、

前記型は、複数の前記第 1 及び第 2 の領域が形成されてなり、

複数の前記ピンを、前記型に前記ピンの先端部を向けて配置し、

前記複数のピンを前記成形材料から抜いて前記成形材料に複数の前記貫通穴を形成するプラットフォームの製造方法。

【請求項 1 5】 請求項 1 4 記載のプラットフォームの製造方法において、前記成形材料を切断する工程をさらに含むプラットフォームの製造方法。

【請求項 1 6】 請求項 1 から請求項 1 5 のいずれかに記載の方法によってプラットフォームを製造し、前記プラットフォームに形成された前記貫通穴に光ファイバを挿入し、前記プラットフォームに光素子を搭載し、前記光素子と前記配線とを電氣的に接続する工程を含む光モジュールの製造方法。

【請求項 1 7】 請求項 1 6 記載の光モジュールの製造方法において、前記光素子を封止する樹脂を設ける工程を含む光モジュールの製造方法。

【請求項 1 8】 請求項 1 7 記載の光モジュールの製造方法において、少なくとも前記光ファイバと前記光素子との間に、前記樹脂として、光を透過する特性を有する樹脂を形成する光モジュールの製造方法。

【請求項 1 9】 請求項 1 6 から請求項 1 8 のいずれかに記載の光モジュールの製造方法において、

請求項 1 3 記載の方法によって前記プラットフォームを製造し、

前記プラットフォームの前記第 3 の領域に半導体チップを搭載する工程を含む光モジュールの製造方法。

【請求項 2 0】 樹脂の成形体と、前記成形体から少なくとも一部が露出する配線と、を有し、前記成形体に光ファイバが挿入される貫通穴が形成されてなるプラットフォーム。

【請求項 2 1】 請求項 2 0 記載のプラットフォームにおいて、前記成形体には、光素子を搭載するための窪みが形成されてなるプラットフォーム。

【請求項 2 2】 請求項 2 1 記載のプラットフォームにおいて、

前記窪みは、複数段を形成する複数の底面を有し、

各底面に前記配線の前記一部が露出してなるプラットフォーム。

【請求項 2 3】 請求項 2 0 から請求項 2 2 のいずれかに記載のプラットフォームにおいて、

前記成形体から底面が露出するように、前記配線に凹部が形成されてなるプラットフォーム。

【請求項 2 4】 請求項 2 3 記載のプラットフォームにおいて、

前記配線に形成された前記凹部に、導電材料が充填されてなるプラットフォーム。

【請求項 2 5】 請求項 2 0 から請求項 2 4 のいずれかに記載のプラットフォームにおいて、

前記成形体に、前記配線に電氣的に接続された電子部品が内蔵されてなるプラットフォーム。

【請求項 2 6】 請求項 2 0 から請求項 2 5 のいずれかに記載のプラットフォームと、

前記貫通穴に挿入された光ファイバと、

前記配線に電氣的に接続されて前記プラットフォームに搭載された光素子と、
を有する光モジュール。

【請求項 2 7】 請求項 2 2 記載のプラットフォームを有する請求項 2 6 記載の光モジュールにおいて、

前記光素子は、前記光ファイバの前記窪み側を向く端面と対向するように前記窪み内に搭載され、

前記光素子の前記光ファイバと対向する面とは反対の面に対向するように搭載され、前記配線と電氣的に接続されてなる半導体チップをさらに前記窪み内に有する光モジュール。

【請求項 2 8】 請求項 2 6 又は請求項 2 7 記載の光モジュールにおいて、
前記光素子を封止する樹脂をさらに有する光モジュール。

【請求項 2 9】 請求項 2 8 記載の光モジュールにおいて、
少なくとも前記光ファイバと前記光素子との間に、前記樹脂として、光を透過

する特性を有する樹脂が形成されてなる光モジュール。

【請求項 3 0】 請求項 2 0 から請求項 2 5 のいずれかに記載された複数のプラットフォームと、

各プラットフォームに搭載された光素子と、

各プラットフォームに取り付けられた光ファイバと、

を含み、

前記光素子は、受光素子又は発光素子であり、

前記光素子は、前記配線の前記露出部に電氣的に接続されて搭載されてなる光伝達装置。

【請求項 3 1】 請求項 2 1 記載のプラットフォームを有する請求項 3 0 記載の光伝達装置において、

各プラットフォームに搭載された半導体チップをさらに有し、

前記光素子は、前記光ファイバの前記窪み側を向く端面と対向するように前記窪み内に搭載され、

前記半導体チップは、前記配線と電氣的に接続され、前記光素子の前記光ファイバと対向する面とは反対の面に対向するように前記窪み内に搭載されてなる光伝達装置。

【請求項 3 2】 請求項 3 0 又は請求項 3 1 記載の光伝達装置において、前記光素子を封止する樹脂をさらに有する光伝達装置。

【請求項 3 3】 請求項 3 2 記載の光伝達装置において、

少なくとも前記光ファイバと前記光素子との間に、前記樹脂として、光を透過する特性を有する樹脂が形成されてなる光伝達装置。

【請求項 3 4】 請求項 3 0 から請求項 3 3 のいずれかに記載の光伝達装置において、

前記受光素子に接続されるプラグと、

前記発光素子に接続されるプラグと、

をさらに含む光伝達装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、プラットフォーム及び光モジュール並びにこれらの製造方法並びに光伝達装置に関する。

【0002】

【発明の背景】

近年、情報通信が高速化・大容量化の傾向にあり、光通信の開発が進んでいる。光通信では、電気信号を光信号に変換し、光信号を光ファイバで送信し、受信した光信号を電気信号に変換する。電気信号と光信号との変換は光素子によって行われる。また、光素子がプラットフォームに搭載されてなる光モジュールが知られている。

【0003】

従来、射出成形体に無電解メッキなどによって配線を形成して部品を製造する方法が知られている。この方法をプラットフォームの製造に適用することもできる。しかし、その場合、配線が射出成形体の表面上に形成されるため、プラットフォームの表面に配線による凸が形成されて平坦性を確保することができない。

【0004】

本発明は、この問題点を解決するものであり、その目的は、配線による凸が形成されないプラットフォーム及び光モジュール並びにこれらの製造方法並びに光伝達装置を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

(1) 本発明に係るプラットフォームの製造方法は、第1及び第2の領域を有する型に、配線を前記第1又は第2の領域に付着させて設け、

ピンを、前記ピンの先端部を前記型に向けて配置し、

成形材料で前記配線及び前記ピンを封止し、

前記ピンを前記成形材料から抜いて前記成形材料に貫通穴を形成し、前記配線及び前記成形材料を前記型から剥離する工程を含む。

【0006】

本発明によれば、型に、配線の端部を付着させて設けてから、成形材料で配線

を封止する。配線の型に対する付着面以外の部分は、成形材料に封止される。そして、成形材料を型で加工し、成形材料とともに配線を型から剥離すると、配線は、型に対する付着面を除き、成形材料に埋め込まれた形態となる。したがって、配線による凸が形成されない。また、ピンを成形材料から抜いて形成された貫通穴には、光ファイバを挿入することができる。

【 0 0 0 7 】

(2) このプラットフォームの製造方法において、

前記配線はワイヤからなり、前記ワイヤの両端部を前記第 1 及び第 2 の領域にボンディングしてもよい。

【 0 0 0 8 】

これによれば、ワイヤの両端部における型に対する付着面は露出し、それ以外の部分は内部に封止されたプラットフォームを得ることができる。これによれば、ワイヤが封止されているので、その断線を防止することができる。

【 0 0 0 9 】

(3) このプラットフォームの製造方法において、

予め前記ボンディングパッドを形成し、前記ボンディングパッドに前記ワイヤをボンディングしてもよい。

【 0 0 1 0 】

これによれば、ワイヤをボンディングしにくい材料からなる型を使用しても、ボンディングパッドを形成しておくことで、ワイヤのボンディングが可能になる。

【 0 0 1 1 】

(4) このプラットフォームの製造方法において、

前記配線は導電層からなり、前記導電層を前記第 1 及び第 2 の領域に形成してもよい。

【 0 0 1 2 】

これによれば、導電層の型に対する付着面が露出し、それ以外の部分が内部に封止されたプラットフォームを得ることができる。

【 0 0 1 3 】

(5) このプラットフォームの製造方法において、
前記型及び前記ピンの少なくとも一方に離型剤を塗布した状態で、前記成形材料により前記配線及び前記ピンを封止してもよい。

【0014】

これによれば、成形材料の型又はピンからの離型性を高めることができる。

【0015】

(6) このプラットフォームの製造方法において、
前記ピンの先端部を前記型に形成された穴に挿入してもよい。

【0016】

これによれば、型に形成された穴によってピンの先端部が覆われ、成形材料がピンの先端を覆わないので、成形材料に貫通穴を形成することができる。

【0017】

(7) このプラットフォームの製造方法において、
前記型の前記第1の領域は、ほぼ平坦に形成されてなり、
前記穴は、前記第1の領域に形成されてなるものであってもよい。

【0018】

これによれば、成形材料における型の第1の領域によって成形された面に、貫通穴が形成される。

【0019】

(8) このプラットフォームの製造方法において、
前記型は、前記第1の領域に凸部を有し、前記凸部の上端面に前記穴が設けられていてもよい。

【0020】

これによれば、成形材料には、型の凸部によって凹部が形成される。ピンを挿入する穴が型の凸部に形成されているので、貫通穴が凹部の底面に形成される。

【0021】

(9) このプラットフォームの製造方法において、
前記型は、前記第1の領域が前記第2の領域よりも突出して形成されてなり、
前記成形材料に、前記型の形状に対応して窪みを形成してもよい。

【 0 0 2 2 】

例えば、窪みを、光素子を収納できる大きさ及び深さで形成してもよい。

【 0 0 2 3 】

(1 0) このプラットフォームの製造方法において、

前記型は、突起を有し、前記突起が設けられた領域に前記配線を付着させ、前記成形材料に凹部を形成してもよい。

【 0 0 2 4 】

これによれば、凹部の内面で、配線と他の部材との電氣的接続を図る構造を得ることができる。

【 0 0 2 5 】

(1 1) このプラットフォームの製造方法において、

前記凹部に導電材料を充填する工程をさらに含んでもよい。

【 0 0 2 6 】

これによれば、導電材料を介して、配線と他の部材とを電氣的に接続することができる。

【 0 0 2 7 】

(1 2) このプラットフォームの製造方法において、

前記型に、前記配線と電氣的に接続させて電子部品を搭載し、

前記成形材料で、前記配線とともに前記電子部品を封止してもよい。

【 0 0 2 8 】

これによれば、電子部品を内蔵するプラットフォームを得ることができる。

【 0 0 2 9 】

(1 3) このプラットフォームの製造方法において、

前記型は、前記第 1 の領域と、前記第 1 の領域より低い位置に設けられる第 2 の領域と、前記第 1 及び第 2 の領域の間に設けられる第 3 の領域と、を有し、

前記配線を設ける工程では、配線を第 1 又は第 2 の領域と、第 3 の領域とに付着させてもよい。

【 0 0 3 0 】

これによれば、複数段形状の型によって、成形材料に、複数段形状の窪みを形

成することができる。窪みには、光素子や半導体チップなどを搭載することができる。

【 0 0 3 1 】

(1 4) このプラットフォームの製造方法において、
前記型は、複数の前記第 1 及び第 2 の領域が形成されてなり、
複数の前記ピンを、前記型に前記ピンの先端部を向けて配置し、
前記複数のピンを前記成形材料から抜いて前記成形材料に複数の前記貫通穴を形成してもよい。

【 0 0 3 2 】

これによれば、成形材料に、複数の光ファイバを挿入するための複数の貫通穴を形成することができる。

【 0 0 3 3 】

(1 5) このプラットフォームの製造方法において、
前記成形材料を切断する工程をさらに含んでもよい。

【 0 0 3 4 】

これによって、成形材料から、複数のプラットフォームを製造することができる。なお、成形材料を、各貫通穴に対応して切断し、1つの貫通穴が形成されたプラットフォームを製造してもよいし、複数の貫通穴を有する領域を切断して、複数の貫通穴が形成されたプラットフォームを製造してもよい。

【 0 0 3 5 】

(1 6) 本発明に係る光モジュールの製造方法は、上記方法によってプラットフォームを製造し、前記プラットフォームに形成された前記貫通穴に光ファイバを挿入し、前記プラットフォームに光素子を搭載し、前記光素子と前記配線とを電氣的に接続する工程を含む。

【 0 0 3 6 】

本発明によれば、上述したプラットフォームの製造方法で説明した作用効果を達成することができる。そして、配線による凸が形成されないプラットフォームに光素子を搭載することができる。

【 0 0 3 7 】

(17) この光モジュールの製造方法において、
前記光素子を封止する樹脂を設ける工程を含んでもよい。

【0038】

こうすることで、光素子を保護することができる。

【0039】

(18) この光モジュールの製造方法において、
少なくとも前記光ファイバと前記光素子との間に、前記樹脂として、光を透過する特性を有する樹脂を形成してもよい。

【0040】

(19) この光モジュールの製造方法において、
上記方法によって前記プラットフォームを製造し、
前記プラットフォームの前記第3の領域に半導体チップを搭載する工程を含んでもよい。

【0041】

本発明によれば、プラットフォームに複数段の窪みを形成することができ、窪みに光素子や半導体チップをコンパクトに収納することができる。

【0042】

(20) 本発明に係るプラットフォームは、樹脂の成形体と、前記成形体から少なくとも一部が露出する配線と、を有し、前記成形体に光ファイバが挿入される貫通穴が形成されてなる。

【0043】

本発明によれば、配線は、一部を除いて成形体に埋め込まれた形態であるから、配線による凸が形成されない。

【0044】

(21) このプラットフォームにおいて、
前記成形体には、光素子を搭載するための窪みが形成されていてもよい。

【0045】

なお、窪みを、光素子を収納できる大きさ及び深さで形成してもよい。

【0046】

(22) このプラットフォームにおいて、
前記窪みは、複数段を形成する複数の底面を有し、
各底面に前記配線の前記一部が露出しているもよい。

【0047】

これによれば、窪みが複数段を形成しているので、各段に光素子や半導体チップなどを搭載することができる。

【0048】

(23) このプラットフォームにおいて、
前記成形体から底面が露出するように、前記配線に凹部が形成されてなるものであってもよい。

【0049】

これによれば、凹部の底面で、配線と他の部材との電氣的接続を図ることができる。

【0050】

(24) このプラットフォームにおいて、
前記配線に形成された前記凹部に、導電材料が充填されていてもよい。

【0051】

これによれば、導電材料を介して、配線と他の部材とを電氣的に接続することができる。

【0052】

(25) このプラットフォームにおいて、
前記成形体に、前記配線に電氣的に接続された電子部品が内蔵されていてもよい。

【0053】

これによれば、電子部品を内蔵するプラットフォームを得ることができる。

【0054】

(26) 本発明に係る光モジュールは、上記プラットフォームと、
前記貫通穴に挿入された光ファイバと、
前記配線に電氣的に接続されて前記プラットフォームに搭載された光素子と、

を有する。

【 0 0 5 5 】

本発明によれば、配線による凸が形成されないプラットフォームに、光素子が搭載される。配線は、樹脂の成形体に埋め込まれたことで保護されている。

【 0 0 5 6 】

(2 7) 上記プラットフォームを有する光モジュールにおいて、

前記光素子は、前記光ファイバの前記窪み側を向く端面と対向するように前記窪み内に搭載され、

前記光素子の前記光ファイバと対向する面とは反対の面に対向するように搭載され、前記配線と電氣的に接続されてなる半導体チップをさらに前記窪み内に有してもよい。

【 0 0 5 7 】

本発明によれば、窪みが複数段を形成しており、窪みに光素子や半導体チップなどをコンパクトに収納することができる。

【 0 0 5 8 】

(2 8) この光モジュールにおいて、

前記光素子を封止する樹脂をさらに有してもよい。

【 0 0 5 9 】

こうすることで、光素子を保護することができる。

【 0 0 6 0 】

(2 9) この光モジュールにおいて、

少なくとも前記光ファイバと前記光素子との間に、前記樹脂として、光を透過する特性を有する樹脂が形成されてもよい。

【 0 0 6 1 】

(3 0) 本発明に係る光伝達装置は、上記複数のプラットフォームと、

各プラットフォームに搭載された光素子と、

各プラットフォームに取り付けられた光ファイバと、

を含み、

前記光素子は、受光素子又は発光素子であり、

前記光素子は、前記配線の前記露出部に電氣的に接続されて搭載されてなる。

【 0 0 6 2 】

本発明によれば、配線による凸が形成されないプラットフォームに、光素子が搭載される。配線は、樹脂の成形体に埋め込まれたことで保護されている。

【 0 0 6 3 】

(3 1) 上記プラットフォームを有する光伝達装置において、
各プラットフォームに搭載された半導体チップをさらに有し、
前記光素子は、前記光ファイバの前記窪み側を向く端面と対向するように前記窪み内に搭載され、

前記半導体チップは、前記配線と電氣的に接続され、前記光素子の前記光ファイバと対向する面とは反対の面に対向するように前記窪み内に搭載されてなるものであってもよい。

【 0 0 6 4 】

これによれば、窪みが複数段を形成しており、窪みに光素子や半導体チップなどをコンパクトに収納することができる。

【 0 0 6 5 】

(3 2) この光伝達装置において、
前記光素子を封止する樹脂をさらに有してもよい。

【 0 0 6 6 】

こうすることで、光素子を保護することができる。

【 0 0 6 7 】

(3 3) この光伝達装置において、
少なくとも前記光ファイバと前記光素子との間に、前記樹脂として、光を透過する特性を有する樹脂が形成されてもよい。

【 0 0 6 8 】

(3 4) この光伝達装置において、
前記受光素子に接続されるプラグと、
前記発光素子に接続されるプラグと、
をさらに含んでもよい。

【 0 0 6 9 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。

【 0 0 7 0 】

（第 1 の実施の形態）

図 1 ～図 7 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。本実施の形態では、図 1 に示す型 1 0 を使用する。

【 0 0 7 1 】

型 1 0 は、その表面に、少なくとも 1 つ（図 1 では複数）の第 1 の領域 1 2 と、その周囲の第 2 の領域 1 4 と、を有する。複数の第 1 の領域 1 2 は、マトリクス状に配列されていてもよい。本実施の形態では、型 1 0 を使用して、複数のプラットフォームを製造することができる。

【 0 0 7 2 】

第 1 の領域 1 2 は、第 2 の領域 1 4 よりも突出して形成されていてもよい。その場合、図 1 に示すように、第 1 及び第 2 の領域 1 2、1 4 は、第 2 の領域 1 4 から傾斜した面（テーパ面）を以て接続されていることが好ましい。この形状によれば、後述する成形材料 4 0（図 6 参照）からの離型性がよい。あるいは、第 1 及び第 2 の領域 1 2、1 4 は、第 2 の領域 1 4 から垂直に立ち上がる面を以て接続されていてもよい。

【 0 0 7 3 】

型 1 0 は、樹脂、ガラス、セラミック又は金属で形成してもよいが、シリコン（例えばシリコンウエーハ）を使用すれば、エッチングによって微細加工ができる。エッチングの条件によって、第 1 及び第 2 の領域 1 2、1 4 を接続する面の形状（テーパ面あるいは垂直面）を決定してもよい。

【 0 0 7 4 】

第 1 の領域 1 2 の表面は、ほぼ平坦に形成されている。第 2 の領域 1 4 の表面も、ほぼ平坦に形成されている。第 1 の領域 1 2 には穴 1 6 が形成されている。穴 1 6 は、ピン 3 2、3 4（図 3 参照）の先端部を挿入するもので、その位置決めをすることもできる。穴 1 6 は、精度よく形成することが好ましい。シリコン

で型 1 0 を形成するときには、エッチングによって穴 1 6 も高精度で形成することができる。

【 0 0 7 5 】

本実施の形態では、図 2 に示すように、型 1 0 に、配線 2 0、2 2 を設ける。詳しくは、配線 2 0、2 2 を、その端部を第 1 又は第 2 の領域 1 2、1 4 に付着させて設ける。

【 0 0 7 6 】

図 2 に示す配線 2 0 は、ワイヤの両端部を、第 1 及び第 2 の領域 1 2、1 4 にボンディングして形成される。なお、第 1 の領域 1 2 では、穴 1 6 を避けてワイヤがボンディングされる。ワイヤは、半導体装置の製造に使用されるワイヤーボンダによってボンディングしてもよい。その場合、熱、圧力、超音波振動のうち少なくとも 1 つによってボンディングする。ワイヤは、金やアルミニウムからなるものであってもよい。

【 0 0 7 7 】

型 1 0 が、シリコンなどの、ワイヤを構成する金属が付着しにくい材料で形成されている場合には、予め、型 1 0 にボンディングパッド 2 4 を形成しておくことが好ましい。ボンディングパッド 2 4 は、導電膜あるいは、導電性でなくても、ワイヤを打つことができる膜であればよい。この場合は、ワイヤ及び導電層 2 4 が一体化して配線 2 0 となる。ボンディングパッド 2 4 の表面は、ワイヤと同じ材料で形成してもよい。例えば、ワイヤが金からなるときには、クロムからなる膜と、その上の金からなる膜と、でボンディングパッド 2 4 を形成してもよい。

【 0 0 7 8 】

図 2 に示す配線 2 2 は、導電層である。導電層は、蒸着やメッキによって形成された金属箔であってもよい。メッキとして無電解メッキを適用するときには、触媒をインクジェット方式で吐出してもよい。導電層は、印刷、ポッティング又はインクジェット方式を適用して形成してもよい。導電層の材料は、導電性ペーストでもよい。金属箔からなる配線 2 2 は、全長にわたって型 1 0 に付着してもよい。導電性ペーストからなる配線 2 2 は、端部が第 1 の領域 1 2 に付着し、中

間部が浮いた状態となって、他の端部が第2の領域14に付着してもよい。

【0079】

配線20、22は、型10から剥離しやすいことが好ましい。例えば、配線22を、スズなどのメッキで形成すれば剥離しやすい。または、印刷によって配線22を形成した場合も、配線22は比較的容易に剥離することができる。

【0080】

次に、図3に示すように、上金型36及び下金型38によって形成されるキャビティ内に、型10を配置する。下金型38には、型10を位置決めして配置できるガイドが形成されていることが好ましい。

【0081】

そして、ピン32、34の先端部を型10に向けて配置する。詳しくは、型10に形成された穴16に、ピン32、34を挿入する。ピン32は、上金型36に固定されており、上金型36及び下金型38が閉じると、ピン32が穴16に入り込むようになっている。また、ピン34は、型開きするときの押し出しピンの機能も有する。ピン32、34は、成形材料40に、光ファイバ30を挿入させるための貫通穴32を形成するものである。したがって、ピン32、34は、光ファイバ30の形状に応じた形状をなす。

【0082】

必要であれば、型10に離型剤（図示せず）を塗布しておく。離型剤（潤滑剤）は、成形材料40との密着性が低いものであり、離型剤を塗布することで、成形材料40の型10からの離型性が良くなる。また、ピン32、34にも、離型剤を塗布しておけば、成形材料40からのピン32、34の抜けが良くなる。

【0083】

図4に示すように、成形材料40で、配線20、22及びピン32、34を封止する。ワイヤをボンディングして形成する配線20は、成形樹脂40で封止されることで、ワイヤの切断が防止される。導電層によって形成する配線22は、型10との付着面を除いて成形材料40で覆われる。

【0084】

本実施の形態では、成形材料40は、モールド樹脂であり、上金型36及び下

金型 3 8 で形成されたキャビティに成形材料 4 0 を充填するが、ポッティングによって成形材料 4 0 を設けてもよい。

【 0 0 8 5 】

成形材料 4 0 は、ピン 3 2、3 4 の先端面を避けて設けられる。穴 1 6 にピン 3 2、3 4 の先端部が挿入されることで、成形材料 4 0 がピン 3 2、3 4 の先端面を覆わないようになっている。穴 1 6 は、ピン 3 2、3 4 の先端を挿入するのに必要な最低限の深さであることが好ましい。特に、穴 1 6 は、第 2 の領域 1 4 の表面よりも下に至らない深さで形成されることが好ましい。

【 0 0 8 6 】

成形材料 4 0 の表面形状は、型 1 0 の第 1 及び第 2 の領域 1 2、1 4 の側の面と、上金型 3 6 の内面と、によって加工される。第 1 の領域 1 2 が第 2 の領域 1 4 よりも突出しているため、成形材料 4 0 に窪み 4 2 が形成される。成形材料 4 0 に離型剤を混入して、型 1 0 との離型性を向上させてもよい。

【 0 0 8 7 】

図 5 に示すように、成形材料 4 0 を硬化させて、ピン 3 4（押し出しピン）を使用して、上金型 3 6 及び下金型 3 8 の型開きを行う。また、ピン 3 2、3 4 を、成形材料 4 0 から抜く。こうすることで、成形材料 4 0 に貫通穴 4 4 が形成される。

【 0 0 8 8 】

図 6 に示すように、成形材料 4 0 を型 1 0 から剥離する。また、成形材料 4 0 とともに、配線 2 0、2 2 の型 1 0 に対する付着面を、型 1 0 から剥離する。配線 2 0 は、ワイヤの端部の面又はボンディングパッド 2 4 の面が、型 1 0 から剥離される。導電層によって形成した配線 2 2 は、その全長にわたって型 1 0 に付着していたので、その全長にわたる面が型 1 0 から剥離される。

【 0 0 8 9 】

本実施の形態では、型 1 0 は複数の第 1 の領域 1 2 を有する。各第 1 の領域 1 2 は、図 9 に示す光素子 5 0 を搭載する領域を成形材料 4 0 に形成する。複数の第 1 の領域 1 2 によって、成形材料 4 0 に、複数の光素子 5 0 を搭載する領域が形成される。

【 0 0 9 0 】

図 7 に示すように、成形材料 4 0 を切断して、プラットフォーム 1 が得られる。成形材料 4 0 は、必要に応じた位置で切断される。プラットフォーム 1 は、成形材料（例えば樹脂） 4 0 からなる成形体を有する。成形体には、窪み 4 2 が形成されている。図 7 に示す例では、1 つの窪み 4 2 ごとに、成形材料 4 0 を切断する例である。窪み 4 2 は、光素子 5 0（図 9 参照）を収容できる大きさであることが好ましい。窪み 4 2 の内側面にテーパが付けられていれば、光素子 5 0 を入れやすい。また、成形体には、一部が露出する状態で配線 2 0、2 2 が埋め込まれている。配線 2 0 は、ワイヤの端部の表面、あるいはワイヤの端部がボンディングされたボンディングパッド 2 4 の表面が、成形体から露出している。配線 2 2 は、その全長にわたる面が露出している。配線 2 0、2 2 は、窪み 4 2 の内面（底面）と、窪み 4 2 の周囲の面と、において露出している。すなわち、配線 2 0、2 2 は、上述した型 1 0 の第 1 の領域 1 2 にて形成された面に第 1 の露出部を有し、型 1 0 の第 2 の領域 1 4 にて形成された面に第 2 の露出部を有する。

【 0 0 9 1 】

図 8 に示すように、プラットフォーム 1 に、光ファイバ 3 0 を取り付けると。詳しくは、プラットフォーム 1 に形成された貫通穴 4 4 に光ファイバ 3 0 を挿入する。必要であれば、貫通穴 4 4 と光ファイバ 3 0 との間に接着剤を設ける。こうして、光ファイバ 3 0 は、その先端面を露出させてプラットフォーム 1 に固定される。詳しくは、プラットフォーム 1 に形成された窪み 4 2 内で、光ファイバ 3 0 がその先端面を露出させて固定される。光ファイバ 3 0 の端部は、窪み 4 2 の底面から突出している。その突出長さは、光素子 5 0 の光学的部分に接触しない長さであることが好ましい。

【 0 0 9 2 】

光ファイバ 3 0 は、コアとこれを同心円状に囲むクラッドとを含むもので、コアとクラッドとの境界で光が反射されて、コア内に光が閉じこめられて伝搬するものである。また、クラッドの周囲は、ジャケットによって保護されることが多い。

【 0 0 9 3 】

次に、図 9 に示すように、プラットフォーム 1 に光素子 5 0 を搭載する。光素子 5 0 は、発光素子であっても受光素子であってもよい。発光素子の一例として面発光素子、特に面発光レーザを使用することができる。面発光レーザなどの面発光素子は、表面から垂直方向に光を発する。光素子 5 0 は、図示しない光学的部分を有する。光素子 5 0 が発光素子であるときは、光学的部分は発光部であり、光素子 5 0 が受光素子であるときは、光学的部分は受光部である。

【 0 0 9 4 】

光素子 5 0 は、光学的部分が形成された側とその反対側とに、電極が形成されている場合が多い。すなわち、光素子 5 0 には、表裏面に電極が形成されており、両方の電極間に電圧を印加するようになっている。なお、図 9 に示す光素子 5 0 には、光学的部分が形成された側の電極にバンプ（又はハンダボール等）が設けられている。

【 0 0 9 5 】

光素子 5 0 は、プラットフォーム 1 に形成された窪み 4 2 に搭載する。窪み 4 2 の深さ内に光素子 5 0 を収容してもよい。図示しない光学的部分を、光ファイバ 3 0 の露出した先端面に向けて、光素子 5 0 をプラットフォーム 1 に搭載する。そして、光学的部分が形成された側の電極と、プラットフォーム 1 の配線 2 0、2 2 の露出部と、を電氣的に接続（又は接合）する。

【 0 0 9 6 】

こうして、図 9 に示す光モジュール 2 が得られる。光モジュール 2 は、光素子 5 0 の光学的部分が形成された側の電極が、配線 2 0、2 2 の第 1 の露出部（窪み 4 2 内の露出部）に電氣的に接続されている。したがって、光素子 5 0 には、配線 2 0、2 2 の第 2 の露出部（プラットフォーム 1 の窪み 4 2 の周囲に形成された露出部）から、電氣的な接続をとることができる。また、光素子 5 0 の裏面（光学的部分が形成された側とは反対側の面）にも、図示しない電極が形成されている。以上のことから、光モジュール 2 は、光ファイバ 3 0 の導き出される方向とは反対側の面に、光素子 5 0 に電圧を印加するための複数の外部端子（光素子 5 0 の光学的部分とは反対側の電極と、配線 2 0、2 2 の第 2 の露出部）を有する。

【 0 0 9 7 】

図 1 0 に示すように、光モジュール 2 を基板 6 0 に取り付けてもよい。基板 6 0 には、配線パターン 6 2 が形成されている。光モジュール 2 の複数の外部端子（光素子 5 0 の光学的部分とは反対側の電極と、配線 2 0、2 2 の第 2 の露出部）と、配線パターン 6 2 とは、導電材料 6 4 によって電氣的に接続されている。導電材料 6 4 は、ハンダ等のろう材や、導電性ペーストであってもよいし、異方性導電膜や異方性導電ペーストであってもよい。

【 0 0 9 8 】

光素子 5 0 を封止するために樹脂 6 6 を設けることが好ましい。図 1 0 に示す例では、樹脂 6 6 は、基板 6 0 と光モジュール 2 との間に設けられるので、アンダーフィル材である。光素子 5 0 の光学的部分（図示せず）と光ファイバ 3 0 の先端面との間に隙間が形成されている場合には、少なくともその隙間に充填される樹脂 6 6 は、透明樹脂である。光素子 5 0 の光学的部分（図示せず）と光ファイバ 3 0 の先端面とが密着しているときには、樹脂 6 6 は光透過性を有していなくてもよい。

【 0 0 9 9 】

図 1 1 には、別の例となる光モジュール 3 を示す。光モジュール 3 は、プラットフォーム 1 に形成された窪み 4 2 に樹脂 6 8 を充填して形成される。光素子 5 0 の光学的部分（図示せず）と光ファイバ 3 0 の先端面との間に隙間が形成されている場合には、少なくともその隙間に充填される樹脂 6 8 は、透明樹脂である。光素子 5 0 の光学的部分（図示せず）と光ファイバ 3 0 の先端面とが密着しているときには、樹脂 6 8 は光透過性を有していなくてもよい。

【 0 1 0 0 】

図 1 1 に示す光モジュール 3 を、図 1 2 に示すように、基板 6 0 に搭載してもよい。基板 6 0 には配線パターン 6 2 が形成されている。光モジュール 3 と配線パターン 6 2 とが電氣的に接続されている。光モジュール 3 は、光素子 5 0 が樹脂 6 8 にて封止されているので、基板 6 0 に取り付けてからアンダーフィル材を充填することは必ずしも必要ではないが、充填してもよい。導電材料 6 4 が導電性接着剤であれば、電氣的な接続と接着を同時に行える。

【 0 1 0 1 】

以上説明したように、本実施の形態によれば、簡単な工程でプラットフォーム 1 を形成することができ、その工程に起因してプラットフォーム 1 には配線 2 0、2 2 による凸が形成されない。プラットフォーム 1 を有する光モジュール 2、3 は、配線 2 0、2 2 を有しているが、平坦な面の一部が電氣的な接続部（露出部）となっている。したがって、光モジュール 2、3 を基板 6 0 に取り付ける工程も行いやすい。

【 0 1 0 2 】

（第 2 の実施の形態）

図 1 3 ～ 図 1 6 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。本実施の形態では、図 1 3 に示す型 1 1 0 を使用する。

【 0 1 0 3 】

型 1 1 0 は、その表面に、少なくとも 1 つの（図 1 3 には複数のうちの 1 つが示されている）第 1 の領域 1 1 2 と、第 2 の領域 1 1 4 と、を有する。第 1 の領域 1 1 2 には、上端面に穴 1 1 6 が形成された凸部 1 1 8 が形成されている。

【 0 1 0 4 】

凸部 1 1 8 は、第 1 の領域 1 1 2 に、配線 2 0、2 2 を付着させる領域を残す大きさに形成されている。凸部 1 1 8 の上端面は平坦であってもよいし、凹凸があっても粗面であってもよい。

【 0 1 0 5 】

穴 1 1 6 は、図 1 に示す穴 1 6 と同様に、ピン 3 2（ピン 3 4 の説明は省略する）を、その先端部を挿入するためのものである。穴 1 1 6 は、第 1 の領域 1 1 2 の高さよりも浅いことが好ましい。詳しくは、ピン 3 2 の先端部が穴 1 1 6 に挿入されたときに、その先端面が、第 1 の領域 1 1 2 の面よりも上に位置するように、穴 1 1 6 の深さを設定することが好ましい。

【 0 1 0 6 】

型 1 1 0 について、その他の構成は、図 1 に示す型 1 0 について説明した内容が該当する。

【 0 1 0 7 】

本実施の形態では、図 1 3 に示すように、型 1 1 0 に、配線 2 0、2 2 を設ける。その詳細は、第 1 の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 0 8 】

次に、図 1 4 に示すように、ピン 3 2 を、型 1 1 0 に先端を向けて配置する。その詳細は、第 1 の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 0 9 】

そして、図 1 5 に示すように、成形材料 4 0 で、配線 2 0、2 2 及びピン 3 2 を封止する。その詳細は、第 1 の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 1 0 】

また、本実施の形態では、第 1 の領域 1 1 2 に凸部 1 1 8 が形成されているので、成形材料 4 0 に、凹部 1 4 4 が形成される。詳しくは、成形材料 4 0 には、窪み 1 4 2 が形成され、窪み 1 4 2 内に凹部 1 4 4 が形成される。

【 0 1 1 1 】

次に、図 1 6 に示すように、成形材料 4 0 を硬化させて、成形材料 4 0 からピン 3 2 を抜いて貫通穴 1 4 6 を形成し、成形材料 4 0 を型 1 1 0 から剥離する。必要であれば、成形材料 4 0 を切断する。こうして、プラットフォーム 1 0 1 が得られる。プラットフォーム 1 0 1 は、成形材料（例えば樹脂）4 0 からなる成形体を有する。成形体には、窪み 1 4 2 が形成されている。

【 0 1 1 2 】

そして、図 1 7 に示すように、貫通穴 1 4 6 に光ファイバ 3 0 を挿入する。光ファイバ 3 0 の先端面は、窪み 1 4 2 の底面から突出しないようになっている。その他の構成は、第 1 の実施の形態で説明した内容が該当する。

【 0 1 1 3 】

光ファイバ 3 0 は、凹部 1 4 4 内に固定されている。光ファイバ 3 0 の先端面は、窪み 1 4 2 の底面（型 1 1 0 の第 1 の領域 1 1 2 によって形成される面）から突出しないことが好ましい。こうすることで、光素子 5 0 の光学的部分に光ファイバ 3 0 の先端が接触することを避けられる。そのためには、図 1 4 に示すように、型 1 1 0 の穴 1 1 6 にピン 3 2 を挿入したときに、ピン 3 2 の先端面が、

第 1 の領域 1 1 2 の面よりも深くないように、穴 1 1 6 の形状を設定しておく。その他の詳細は、第 1 の形態で説明した内容が該当する。

【 0 1 1 4 】

また、プラットフォーム 1 0 1 に光素子 5 0 を搭載して、光モジュール 1 0 2 が得られる。詳しくは、第 1 の実施の形態で説明した通りである。また、プラットフォーム 1 0 1 の光素子 5 0 を搭載する面から光ファイバ 3 0 の先端が突出しないので、光素子 5 0 の光学的部分に光ファイバ 3 0 が当たらない。

【 0 1 1 5 】

図 1 8 に示すように、光モジュール 1 0 2 を基板 6 0 に取り付けてもよい。光素子 5 0 を封止するために樹脂 1 6 6 を設けることが好ましい。図 1 8 に示す例では、樹脂 1 6 6 は、基板 6 0 と光モジュール 1 0 2 との間に設けられるので、アンダーフィル材である。光素子 5 0 の光学的部分（図示せず）と光ファイバ 3 0 の先端面との間に隙間（凹部 1 4 4）が形成されているので、少なくともその隙間に充填される部分において、樹脂 1 6 6 は透明樹脂である。その他の詳細は、第 1 の実施の形態で説明した内容が該当する。

【 0 1 1 6 】

図 1 9 には、別の例となる光モジュール 1 0 3 を示す。光モジュール 1 0 3 は、プラットフォーム 1 0 1 に形成された窪み 1 4 2 に樹脂 1 6 8、1 7 0 を充填して形成される。光素子 5 0 の光学的部分（図示せず）と光ファイバ 3 0 の先端面との間に隙間（凹部 1 4 4）が形成されているので、少なくともその隙間に充填される樹脂 1 6 8 は、透明樹脂であり、それ以外の領域（窪み 1 4 2）に充填される樹脂 1 7 0 は、光透過性を有しない樹脂であってもよい。

【 0 1 1 7 】

図 1 9 に示す光モジュール 1 0 3 を、図 2 0 に示すように、基板 6 0 に搭載してもよい。詳しくは、第 1 の実施の形態で説明した通りである。

【 0 1 1 8 】

以上説明したように、本実施の形態によれば、プラットフォーム 1 0 1 における光素子 5 0 の搭載面となる窪み 1 4 2 の底面から、光ファイバ 3 0 が突出しない。したがって、光素子 5 0 の光学的部分に光ファイバ 3 0 が接触することを防

止できる。その他の効果については、第 1 の実施の形態で説明した通りである。

【 0 1 1 9 】

(第 3 の実施の形態)

図 2 1 は、本発明を適用した第 3 の実施の形態に係る光モジュールを示す図である。この光モジュール 2 0 2 は、プラットフォーム 2 1 0 と、複数の光素子 5 0 と、複数の光ファイバ 3 0 と、を含む。各光ファイバ 3 0 は各光素子 5 0 に対応して設けられている。プラットフォーム 2 0 1 は、第 1 の実施の形態で説明した複数のプラットフォーム 1 を一体化させた形状をなしている。

【 0 1 2 0 】

図 2 1 に示す光モジュール 2 0 2 は、4 つの光素子 5 0 を有し、カラー画像信号の伝送に使用するときには、光素子 5 0 及び光ファイバ 3 0 は、R、G、B の信号及びクロック信号の送受信に使用される。

【 0 1 2 1 】

本実施の形態に係る光モジュール 2 0 2 は、成形材料 4 0 を、複数の光素子 5 0 を搭載する領域を含む位置で切断して製造することができる。

【 0 1 2 2 】

(第 4 の実施の形態)

図 2 2 ～図 2 5 は、本発明を適用した第 4 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。本実施の形態では、図 2 2 に示す型 3 1 0 を使用する。

【 0 1 2 3 】

型 3 1 0 は、その表面に、少なくとも 1 つの (図 2 2 には複数のうちの 1 つが示されている) 第 1 の領域 3 1 2 と、第 2 の領域 3 1 4 と、を有する。第 1 の領域 3 1 2 には、上端面に穴 3 1 6 が形成された凸部 3 1 8 が形成されている。凸部 3 1 8 及び穴 3 1 6 は、図 1 3 に示す凸部 1 1 8 及び穴 1 1 6 と同じ構成である。

【 0 1 2 4 】

型 3 1 0 は、突起 3 2 0 を有する。突起 3 2 0 は、第 1 及び第 2 の領域 3 1 2 、3 1 4 の少なくとも一方 (図 2 2 では両方) に形成されている。突起 3 2 0 は

、配線 2 0、2 2 を上端面に付着させるためのものである。突起 3 2 0 によって、成形材料 4 0 に、配線 2 0、2 2 が底面に露出する凹部 3 4 6（図 2 5 参照）が形成される。

【 0 1 2 5 】

型 3 1 0 について、その他の構成は、図 1 に示す型 1 0 について説明した内容が該当する。

【 0 1 2 6 】

本実施の形態では、図 2 2 に示すように、型 3 1 0 に、配線 2 0、2 2 を設ける。詳しくは、突起 3 2 0（例えばその上端面）に一部を付着させて、配線 2 0、2 2 を設ける。ワイヤを突起 3 2 0 にボンディングするときには、突起 3 2 0 に予めボンディングパッド 2 4 を形成しておく。その他の内容は、第 1 の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 2 7 】

次に、図 2 3 に示すように、ピン 3 2（ピン 3 4 の説明は省略する）を、型 3 1 0 に先端を向けて配置する。その詳細は、図 1 4 に示す形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 2 8 】

そして、図 2 4 に示すように、成形材料 4 0 で、配線 2 0、2 2 及びピン 3 2 を封止する。その詳細は、図 1 5 に示す形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 2 9 】

次に、図 2 5 に示すように、成形材料 4 0 を硬化させて、成形材料 4 0 からピン 3 2 を抜いて貫通穴 3 4 8 を形成し、成形材料 4 0 を型 3 1 0 から剥離する。必要であれば、成形材料 4 0 を切断する。こうして、プラットフォーム 3 0 1 が得られる。プラットフォーム 3 0 1 は、成形材料（例えば樹脂）4 0 からなる成形体を有する。成形体には、窪み 3 4 2 が形成されている。

【 0 1 3 0 】

プラットフォーム 3 0 1 には、配線 2 0、2 2 の一部が内面（側面又は底面）に露出する凹部 3 4 6 が形成されている。凹部 3 4 6 は、型 3 1 0 の突起 3 2 0 によって形成されたものである。その他の構成は、第 2 の実施の形態で説明した

内容が該当する。

【0131】

そして、図26に示すように、貫通穴348に光ファイバ30を挿入する。光ファイバ30の先端部は、窪み342の底面に形成された凹部344内で突出するが、光ファイバ30の先端面は、窪み342の底面から突出しないようになっている。

【0132】

次に、プラットフォーム301に光素子50を搭載して、光モジュール302が得られる。光モジュール302は、プラットフォーム301に形成された窪み342に樹脂368、370を充填して形成される。光素子50の光学的部分（図示せず）と光ファイバ30の先端面との間に隙間（凹部344）が形成されているので、少なくともその隙間に充填される樹脂368は、透明樹脂であり、それ以外の領域（窪み342）に充填される樹脂370は、光透過性を有しない樹脂であってもよい。

【0133】

また、配線20、22が内面に露出していた凹部346には、図26に示すように、導電材料380を充填してもよい。この状態では、配線20、22の一部は、露出せずに、凹部346の内面の一部を形成する。導電材料380は、ハンダ等のろう材であってもよいし、導電ペーストであってもよい。図26に示す例では、光素子50の電極（パンプ）が、窪み342内に形成された凹部346に充填された導電材料380に接合されている。

【0134】

図27に示すように、光モジュール302には、外部との電氣的接続を図るために、ハンダボールなどの外部端子382を設けてもよい。例えば、図27に示すように、光素子50における光ファイバ30とは反対側に形成された電極（図示せず）に外部端子382を設ける。また、窪み342の周囲で、プラットフォーム301に形成された凹部346に充填された導電材料380に、外部端子382を設ける。光モジュール302は、第1の実施の形態で説明したように、基板に搭載してもよい。

【 0 1 3 5 】

以上説明したように、本実施の形態によれば、第 2 の実施の形態で説明した効果に加えて、凹部 3 4 6 に導電材料 3 8 0 を充填してあるので、電氣的な接続を図りやすい。

【 0 1 3 6 】

(第 5 の実施の形態)

図 2 8 ～図 3 1 は、本発明を適用した第 5 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。本実施の形態では、図 2 8 に示す型 4 1 0 を使用する。

【 0 1 3 7 】

型 4 1 0 は、その表面に、少なくとも 1 つの（図 2 8 には複数のうちの 1 つが示されている）第 1 の領域 4 1 2 と、第 2 の領域 4 1 4 と、を有する。第 1 の領域 4 1 2 には、上端面に穴 4 1 6 が形成された凸部 4 1 8 が形成されている。凸部 4 1 8 及び穴 4 1 6 は、図 1 3 に示す凸部 1 1 8 及び穴 1 1 6 と同じ構成である。

【 0 1 3 8 】

型 3 1 0 は、突起 4 2 0 を有する。突起 4 2 0 は、第 1 及び第 2 の領域 4 1 2 、 4 1 4 の少なくとも一方（図 2 8 では両方）に形成されている。突起 4 2 0 は、配線 2 0 、 2 2 を表面（例えば上端面）に付着させるためのものである。突起 4 2 0 によって、成形材料 4 0 に、配線 2 0 、 2 2 が内面（底面又は側面）に露出する凹部 4 4 6 （図 3 1 参照）が形成される。また、配線 2 0 、 2 2 を付着させずに、電子部品を支持するための突起 4 2 2 を形成してもよい。

【 0 1 3 9 】

型 4 1 0 について、その他の構成は、図 1 に示す型 1 0 について説明した内容が該当する。本実施の形態では、図 2 8 に示すように、型 4 1 0 に、配線 2 0 、 2 2 を設ける。詳しくは、第 4 の実施の形態で説明した通りである。

【 0 1 4 0 】

さらに、型 4 1 0 に、電子部品 4 3 0 を搭載する。電子部品 4 3 0 は、配線 2 0 、 2 2 に電氣的に接続される。例えば、突起 4 2 0 に付着した配線 2 0 、 2 2

上に電子部品 4 3 0 を搭載したり、電子部品 4 3 0 に配線 2 0 をボンディングする。電子部品 4 3 0 として、抵抗器、コンデンサ、コイル、発振器、フィルタ、温度センサ、サーミスタ、バリスタ、ポリウム、ヒューズ、ペルチエ素子又はヒートパイプ等の冷却用部品などが挙げられる。

【 0 1 4 1 】

次に、図 2 9 に示すように、ピン 3 2 (ピン 3 4 の説明は省略する) を、型 4 1 0 に先端を向けて配置する。その詳細は、図 1 4 に示す形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 4 2 】

そして、図 3 0 に示すように、成形材料 4 0 で、配線 2 0、2 2、ピン 3 2 及び電子部品 4 3 0 を封止する。その詳細は、図 1 5 に示す形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 4 3 】

次に、図 3 1 に示すように、成形材料 4 0 を硬化させて、成形材料 4 0 からピン 3 2 を抜いて貫通穴 4 5 0 を形成し、成形材料 4 0 を型 4 1 0 から剥離する。必要であれば、成形材料 4 0 を切断する。詳しくは、第 2 の形態で説明した内容が該当する。

【 0 1 4 4 】

こうして、プラットフォーム 4 0 1 が得られる。プラットフォーム 4 0 1 は、成形材料 (例えば樹脂) 4 0 からなる成形体を有する。成形体には、窪み 4 4 2 が形成されている。

【 0 1 4 5 】

プラットフォーム 4 0 1 には、配線 2 0、2 2 の一部が内面 (側面又は底面) に露出する凹部 4 4 6 が形成されている。凹部 4 4 6 は、型 4 1 0 の突起 4 2 0 によって形成されたものである。また、プラットフォーム 4 0 1 には、電子部品 4 3 0 を支持するための突起 4 2 2 によっても凹部 4 4 8 が形成されている。電子部品 4 3 0 の電極が突起 4 2 2 上に載せられるのであれば、凹部 4 4 8 内に電子部品 4 3 0 の電極が凹部 4 4 8 内に露出する。その他の構成は、第 2 の実施の形態で説明した内容が該当する。

【 0 1 4 6 】

図 3 2 に示すように、貫通穴 4 5 0 に光ファイバ 3 0 を挿入する。光ファイバ 3 0 の先端部は、凹部 4 4 4 内で突出するが、窪み 4 4 2 の底面から突出しないようになっている。

【 0 1 4 7 】

図 3 2 に示すように、プラットフォーム 4 0 1 に光素子 5 0 を搭載して、光モジュール 4 0 2 が得られる。光モジュール 4 0 2 は、プラットフォーム 4 0 1 に形成された窪み 4 4 2 に樹脂 4 6 8、4 7 0 を充填して形成される。詳しくは、第 4 の実施の形態で説明した通りである。

【 0 1 4 8 】

また、凹部 4 4 6 には、図 3 2 に示すように、導電材料 4 8 0 を充填してもよい。詳しくは、第 4 の実施の形態で説明した通りである。なお、凹部 4 4 8 にも導電材料 4 8 0 を充填してもよい。

【 0 1 4 9 】

図 3 3 に示すように、光モジュール 4 0 2 には、外部との電氣的接続を図るために、ハンダボールなどの外部端子 4 8 2 を設けてもよい。詳しくは、第 4 の実施の形態で説明した通りである。光モジュール 4 0 2 は、第 1 の実施の形態で説明したように、基板に搭載してもよい。

【 0 1 5 0 】

以上説明したように、本実施の形態によれば、第 2 の実施の形態で説明した効果に加えて、凹部 4 4 6 に導電材料 4 8 0 を充填してあるので、電氣的な接続を図りやすい。また、本実施の形態に係るプラットフォーム 4 0 1 は、電子部品 4 3 0 を内蔵しており、成形体自体に電子部品 4 3 0 が封止されているので、品質の安定化を図ることができる。

【 0 1 5 1 】

(第 6 の実施の形態)

図 3 4 ～図 3 5 は、本発明を適用した第 6 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。本実施の形態では、図 3 4 に示す型 5 1 0 を使用する。

【 0 1 5 2 】

型 5 1 0 は、複数段を有する山形状をなし、その平面形状は円形であっても矩形であってもよい。型 5 1 0 は、第 1 の領域 5 1 1 と、第 1 の領域 5 1 1 よりも低く位置する第 2 の領域 5 1 2 と、第 1 及び第 2 の領域 5 1 1、5 1 2 の間に位置する少なくとも 1 段（図 3 4 では複数段）の第 3 の領域 5 1 3 と、を有する。図 3 4 には、1 つの第 1 の領域 5 1 1 が示されているが、型 5 1 0 は、複数の第 1 の領域 5 1 1 を有していてもよい。

【 0 1 5 3 】

第 1 の領域 5 1 1 には、上端面に穴 5 1 6 が形成された凸部 5 1 8 が形成されている。凸部 5 1 8 及び穴 5 1 6 は、図 1 3 に示す凸部 1 1 8 及び穴 1 1 6 と同じ構成である。

【 0 1 5 4 】

型 5 1 0 は、突起 5 2 0 を有する。図 3 4 に示す突起 5 2 0 は、第 2 及び第 3 の領域 5 1 2、5 1 3 に形成されているが、いずれか一方のみに形成されてもよく、第 1 の領域 5 1 1 に形成されてもよい。突起 5 2 0 は、配線 2 0、2 2 を表面（例えば上端面）に付着させるためのものである。突起 5 2 0 によって、成形材料 4 0 に、配線 2 0、2 2 が内面（底面又は側面）に露出する凹部 5 4 6（図 3 5 参照）が形成される。

【 0 1 5 5 】

型 5 1 0 について、その他の構成は、図 1 に示す型 1 0 について説明した内容が該当する。本実施の形態では、図 3 4 に示すように、型 5 1 0 に、配線 2 0、2 2 を設ける。

【 0 1 5 6 】

例えば、複数の配線 2 0 のそれぞれの一部（例えば一方の端部）を、第 1 又は第 2 の領域 5 1 1、5 1 2 に付着させ、他の一部（例えば他方の端部）を、第 3 の領域 5 1 3 に付着させる。または、複数段の第 3 の領域 5 1 3 に、いずれかの配線 2 0 の両端部を付着させる。あるいは、第 3 の領域 5 1 3 をとばして、第 1 及び第 2 の領域 5 1 1、5 1 2 に、配線 2 0 を付着させてもよい。なお、配線 2 0 を付着させる前に、第 1 の実施の形態で説明したように、ボンディングパッド

2 4 を形成しておいてもよい。また、型 5 1 0 に付着した配線 2 0 の上に、他の配線 2 0 を付着させてもよい。

【 0 1 5 7 】

同様に、配線 2 2 を、その一部を第 1、2 又は第 3 の領域 5 1 1、5 1 2、5 1 3 に付着させて設ける。図 3 4 に示す例では、第 1、2 及び 3 の領域 5 1 1、5 1 2、5 1 3 に、連続的に配線 2 2 が形成されている。これとは異なる例として、第 1 及び第 3 の領域 5 1 1、5 1 3 間にのみ、あるいは第 3 及び第 2 の領域 5 1 3、5 1 2 間にのみ配線 2 2 を形成してもよい。

【 0 1 5 8 】

さらに、型 5 1 0 に、電子部品 5 3 0 を搭載してもよい。電子部品 5 3 0 は、配線 2 0、2 2 に電氣的に接続される。例えば、突起 5 2 0 に付着した配線 2 2 上に電子部品 5 3 0 を搭載する。必要であれば、電子部品 5 3 0 の電極と、配線 2 0、2 2 とをワイヤ 5 3 2 など電氣的に接続してもよい。その他の詳細は、第 5 の実施の形態で説明した通りである。

【 0 1 5 9 】

次に、ピン 3 2（ピン 3 4 の説明は省略する）を、型 5 1 0 に先端を向けて配置する。その詳細は、図 1 4 に示す形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 6 0 】

成形材料 4 0 で、配線 2 0、2 2、ピン 3 2 及び電子部品 5 3 0 を封止する。そして、成形材料 4 0 を硬化させて、成形材料 4 0 からピン 3 2 を抜いて貫通穴 5 4 8 を形成し、成形材料 4 0 を型 5 1 0 から剥離する。必要であれば成形材料 4 0 を切断する。こうして、図 3 5 に示すプラットフォーム 5 0 1 を形成する。その詳細は、図 1 5 ～図 1 6 に示す形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 1 6 1 】

プラットフォーム 5 0 1 は、成形材料（例えば樹脂）4 0 からなる成形体を有する。成形体には、窪み 5 4 2 が形成されている。窪み 5 4 2 内には、複数の底面 5 5 1 ～5 5 3 によって段が形成されている。最も深い底面 5 5 1 には、凹部 5 4 4 が形成されている。

【 0 1 6 2 】

窪み 5 4 2 の底面 5 5 1 ～ 5 5 3 に、配線 2 0、2 2 の一部が露出している。最も深い底面 5 5 1 には、底面 5 5 1 と面一で配線 2 0、2 2 が露出している。最も深い底面 5 5 1 以外の底面 5 5 2、5 5 3 には、配線 2 0、2 2 の一部が内面（側面又は底面）に露出する凹部 5 4 6 が形成されている。凹部 5 4 6 は、型 5 1 0 の突起 5 2 0 によって形成されたものである。また、プラットフォーム 5 0 1 の表面であって窪み 5 4 2 の周囲にも、凹部 5 4 6 が形成されている。

【 0 1 6 3 】

凹部 5 4 6 には、図 3 6 に示すように、導電材料 5 8 0 を充填してもよい。詳しくは、第 4 の実施の形態で説明した通りである。

【 0 1 6 4 】

次に、図 3 6 に示すように、プラットフォーム 5 0 1 の貫通穴 5 4 8 に光ファイバ 3 0 を挿入する。光ファイバ 3 0 の先端部は、凹部 5 4 4 内で突出するが、光ファイバ 3 0 の先端面は、最も深い底面 5 5 1 から突出しないようになっている。

【 0 1 6 5 】

また、プラットフォーム 5 0 1 に光素子 5 0 を搭載する。詳しくは、光学的部分 5 2 を光ファイバ 3 0 の先端面に向けて、窪み 5 4 2 の最も深い底面 5 5 1 に光素子 5 0 を搭載する。また、配線 2 0、2 2 の底面 5 5 1 に露出した部分と、光素子 5 0 の電極（バンプ）とを電氣的に接続する。例えば、フェースダウンボンディングを適用する。また、光素子 5 0 と光ファイバ 3 0 との間には、樹脂 5 6 8 を充填する。特に、光ファイバ 3 0 の先端面と、光素子 5 0 の光学的部分 5 2 との間で、樹脂 5 6 8 は、光透過性を有する（透明である）。

【 0 1 6 6 】

続いて、窪み 5 4 2 内で光素子 5 0 よりも浅い位置に半導体チップ 5 6 0、5 6 2 を搭載する。半導体チップ 5 6 0、5 6 2 は、光素子 5 0 を駆動するためのものである。半導体チップ 5 6 0、5 6 2 には、光素子 5 0 を駆動するための回路が内蔵されている。半導体チップ 5 6 0、5 6 2 には、内部の回路に電氣的に接続された複数の電極（又はパッド）が形成されている。なお、半導体チップの代わりに、半導体を使用しないで形成された回路を内蔵するチップを適用しても

、同じ作用効果を達成することができる。

【0167】

最も深い底面551以外の底面552、553に、半導体チップ560、562を搭載する。底面552、553は、型510の第3の領域513によって形成された面である。また、配線20、22の底面552、553に露出した部分と、半導体チップ560の電極（パンプ）とを電氣的に接続する。配線20、22は、底面552、553に形成された凹部546（図35参照）内で露出している。あるいは、配線20、22の一部は、底面552、553に形成された凹部546（図35参照）の内壁面の一部を形成している。

【0168】

光素子50及び半導体チップ560、562は、樹脂570によって封止する。すなわち、窪み542に樹脂570を充填する。光素子50の光学的部分52と光ファイバ30の先端面との間の隙間が、透明な樹脂568によって埋められていれば、樹脂570は光透過性を有していてもいなくてもよい。

【0169】

こうして、光モジュール502が得られる。光モジュール502には、外部との電氣的接続を図るために、ハンダボールなどの外部端子582を設けてもよい。詳しくは、第4の実施の形態で説明した通りである。光モジュール502は、第1の実施の形態で説明したように、基板に搭載してもよい。

【0170】

以上説明したように、本実施の形態によれば、他の実施の形態で説明した効果に加えて、光モジュール502に、半導体チップ560、562をコンパクトに内蔵させることができる。

【0171】

（第7の実施の形態）

図37は、本発明を適用した第7の実施の形態に係る光伝達装置を示す図である。光伝送装置590は、コンピュータ、ディスプレイ、記憶装置、プリンタ等の電子機器592を相互に接続するものである。電子機器592は、情報通信機器であってもよい。光伝送装置590は、ケーブル594の両端にプラグ596

が設けられたものであってもよい。ケーブル 5 9 4 は、1 つ又は複数（少なくとも一つ）の光ファイバ 3 0（図 8 参照）を含む。プラグ 5 9 6 は、半導体チップを内蔵してもよい。

【 0 1 7 2 】

光ファイバ 3 0 の一方の端部に接続される光素子 5 0 は、発光素子である。一方の電子機器 5 9 2 から出力された電気信号は、発光素子である光素子 5 0 によって光信号に変換される。光信号は光ファイバ 3 0 を伝わり、他方の光素子 5 0 に入力される。この光素子 5 0 は、受光素子であり、入力された光信号が電気信号に変換される。電気信号は、他方の電子機器 5 9 2 に入力される。こうして、本実施の形態に係る光伝達装置 5 9 0 によれば、光信号によって、電子機器 5 9 2 の情報伝達を行うことができる。

【 0 1 7 3 】

（第 8 の実施の形態）

図 3 8 は、本発明を適用した第 8 の実施の形態に係る光伝達装置の使用形態を示す図である。光伝送装置 5 9 0 は、電子機器 6 0 0 間を接続する。電子機器 6 0 0 として、液晶表示モニター又はデジタル対応の C R T（金融、通信販売、医療、教育の分野で使用されることがある。）、液晶プロジェクタ、プラズマディスプレイパネル（P D P）、デジタル T V、小売店のレジ（P O S（Point of Sale Scanning）用）、ビデオ、チューナー、ゲーム装置、プリンター等が挙げられる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 2】

図 2 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 3】

図 3 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方

法を示す図である。

【図 4】

図 4 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 5】

図 5 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 6】

図 6 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 7】

図 7 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 8】

図 8 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 9】

図 9 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 1 0】

図 1 0 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 1 1】

図 1 1 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 1 2】

図 1 2 は、本発明を適用した第 1 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 1 3】

図 1 3 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 1 4】

図 1 4 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 1 5】

図 1 5 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 1 6】

図 1 6 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 1 7】

図 1 7 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 1 8】

図 1 8 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 1 9】

図 1 9 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 2 0】

図 2 0 は、本発明を適用した第 2 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 2 1】

図 2 1 は、本発明を適用した第 3 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 2 2】

図 2 2 は、本発明を適用した第 4 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 2 3】

図 2 3 は、本発明を適用した第 4 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 2 4】

図 2 4 は、本発明を適用した第 4 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 2 5】

図 2 5 は、本発明を適用した第 4 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 2 6】

図 2 6 は、本発明を適用した第 4 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 2 7】

図 2 7 は、本発明を適用した第 4 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 2 8】

図 2 8 は、本発明を適用した第 5 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 2 9】

図 2 9 は、本発明を適用した第 5 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 3 0】

図 3 0 は、本発明を適用した第 5 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 3 1】

図 3 1 は、本発明を適用した第 5 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 3 2】

図 3 2 は、本発明を適用した第 5 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法

を示す図である。

【図 3 3】

図 3 3 は、本発明を適用した第 5 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 3 4】

図 3 4 は、本発明を適用した第 6 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 3 5】

図 3 5 は、本発明を適用した第 6 の実施の形態に係るプラットフォームの製造方法を示す図である。

【図 3 6】

図 3 6 は、本発明を適用した第 6 の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図である。

【図 3 7】

図 3 7 は、本発明を適用した第 7 の実施の形態に係る光伝達装置を示す図である。

【図 3 8】

図 3 8 は、本発明を適用した第 8 の実施の形態に係る光伝達装置の使用形態を示す図である。

【符号の説明】

- 1 プラットフォーム
- 2 光モジュール
- 3 光モジュール
- 1 0 型
- 1 2 第 1 の領域
- 1 4 第 2 の領域
- 1 6 穴
- 2 0 配線
- 2 2 配線

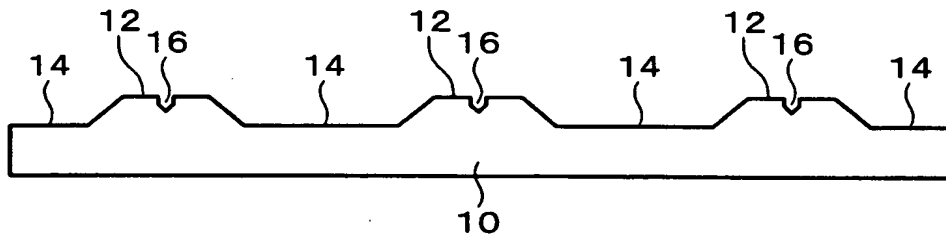
2 4 ボンディングパッド
3 0 光ファイバ
3 2 ピン
3 4 ピン
4 0 成形材料
4 2 窪み
4 4 貫通穴
5 0 光素子
5 2 光学的部分
1 0 1 プラットフォーム
1 0 2 光モジュール
1 0 3 光モジュール
1 1 0 型
1 1 2 第 1 の領域
1 1 4 第 2 の領域
1 1 6 穴
1 1 8 凸部
1 4 2 窪み
1 4 4 凹部
1 4 6 貫通穴
1 6 6 樹脂
1 6 8 樹脂
1 7 0 樹脂
2 0 1 プラットフォーム
2 0 2 光モジュール
3 0 1 プラットフォーム
3 0 2 光モジュール
3 1 0 型
3 1 2 第 1 の領域

3 1 4 第 2 の領域
3 1 6 穴
3 1 8 凸部
3 2 0 突起
3 4 2 窪み
3 4 4 凹部
3 4 6 凹部
3 4 8 貫通穴
3 6 8 樹脂
3 7 0 樹脂
3 8 0 導電材料
4 0 1 プラットフォーム
4 0 2 光モジュール
4 1 0 型
4 1 2 第 1 の領域
4 1 4 第 2 の領域
4 1 6 穴
4 1 8 凸部
4 2 0 突起
4 2 2 突起
4 3 0 電子部品
4 4 2 窪み
4 4 4 凹部
4 4 6 凹部
4 5 0 貫通穴
4 6 8 樹脂
4 7 0 樹脂
4 8 0 導電材料
5 0 1 プラットフォーム

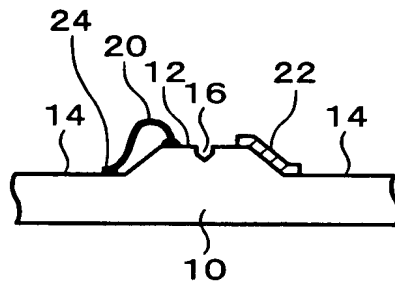
5 0 2 光モジュール
5 1 0 型
5 1 1 第 1 の領域
5 1 2 第 2 の領域
5 1 3 第 3 の領域
5 1 6 穴
5 1 8 凸部
5 2 0 突起
5 3 0 電子部品
5 4 2 窪み
5 4 4 凹部
5 4 6 凹部
5 4 8 貫通穴
5 6 0 半導体チップ
5 6 2 半導体チップ
5 6 8 樹脂
5 7 0 樹脂
5 8 0 導電材料

【書類名】 図面

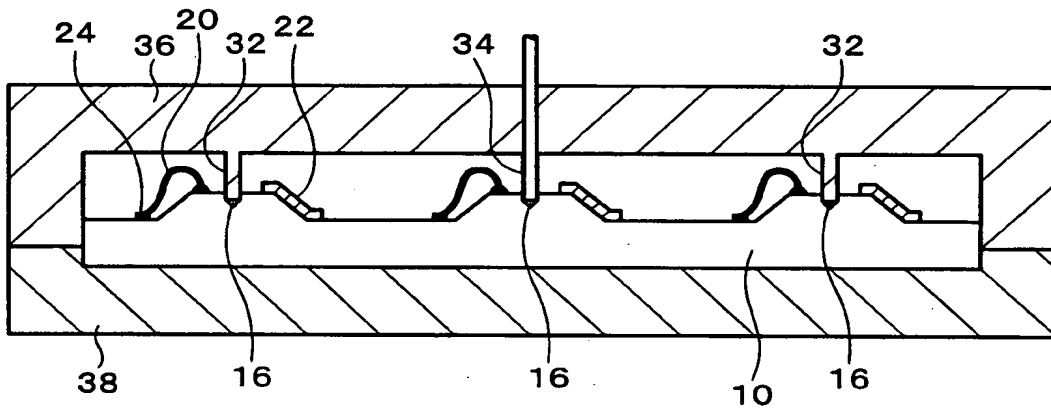
【図 1】



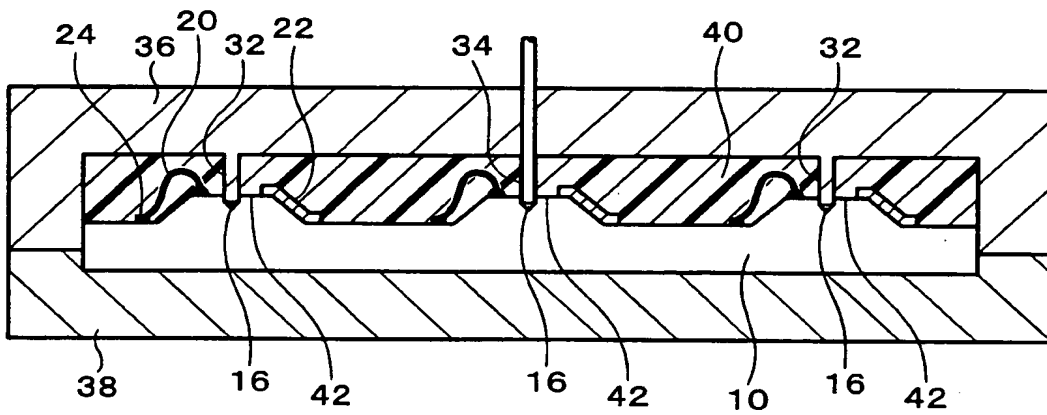
【図 2】



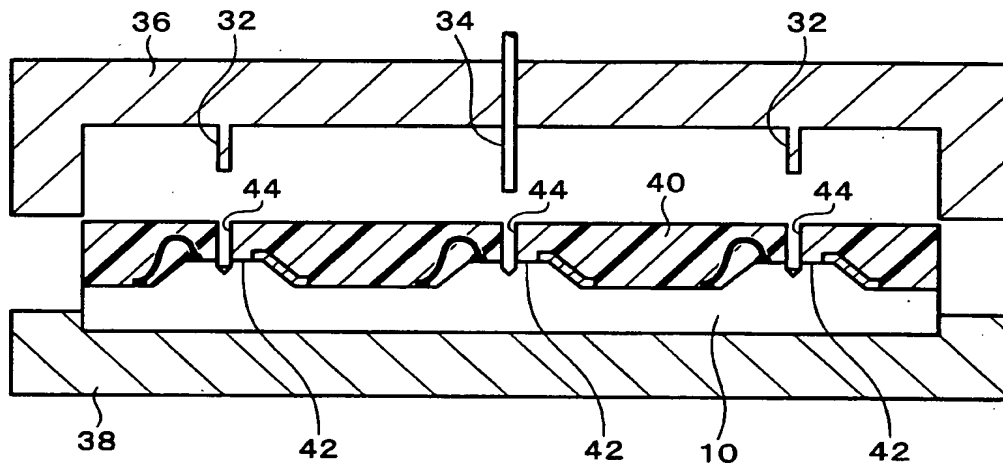
【図 3】



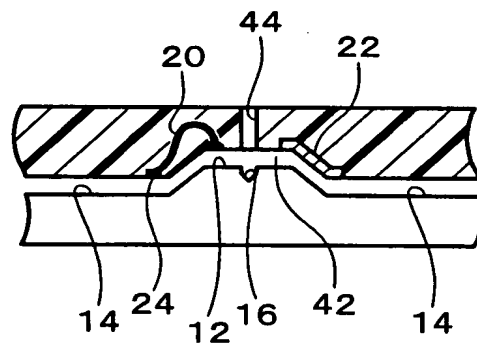
【図 4】



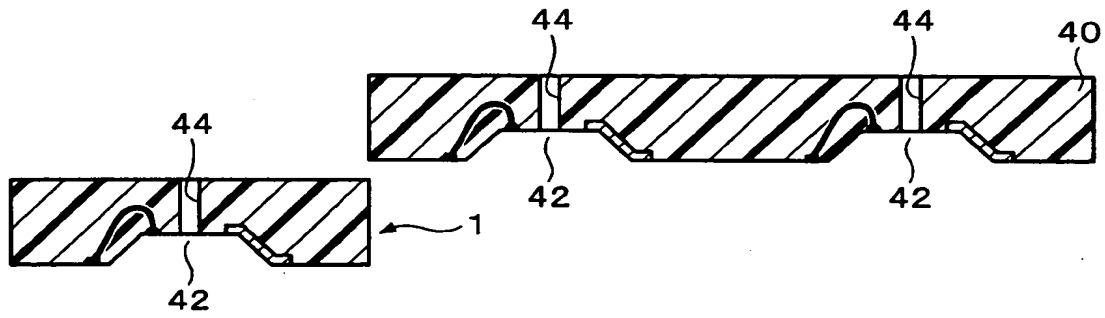
【図 5】



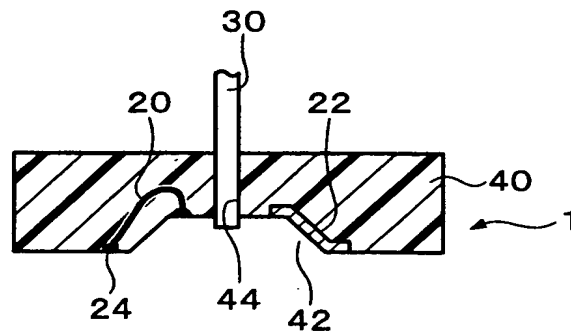
【図 6】



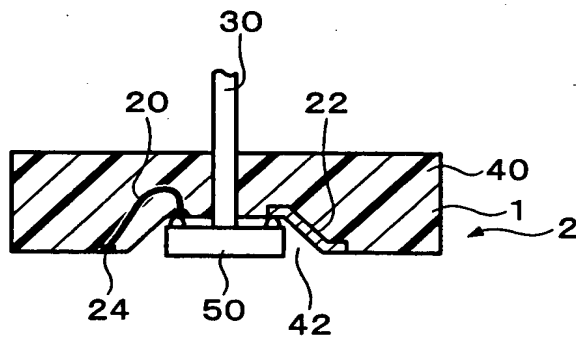
【図 7】



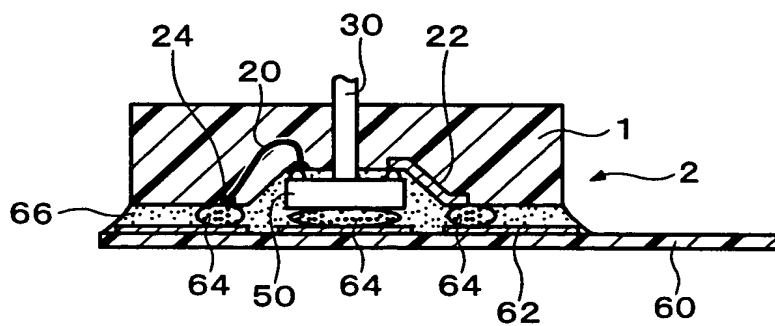
【図 8】



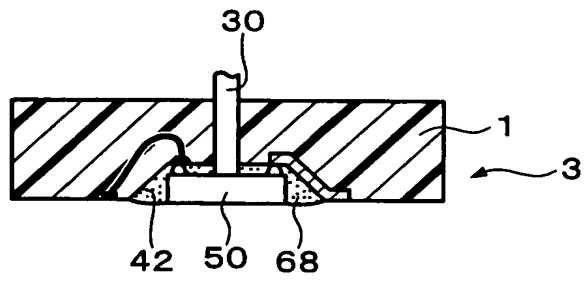
【図 9】



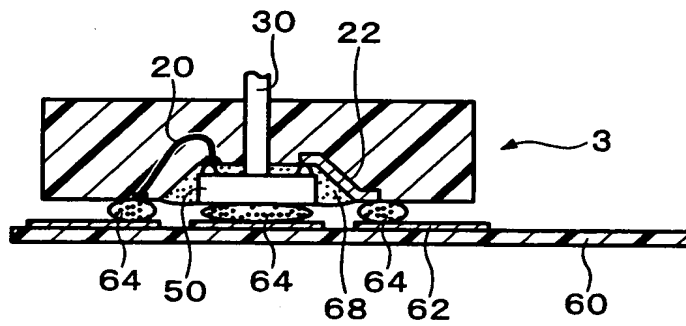
【図 10】



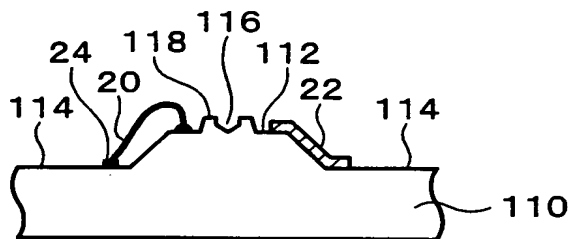
【図 1 1】



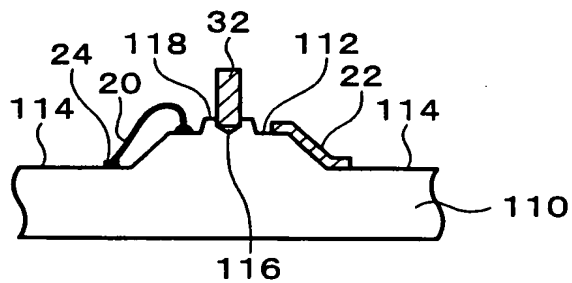
【図 1 2】



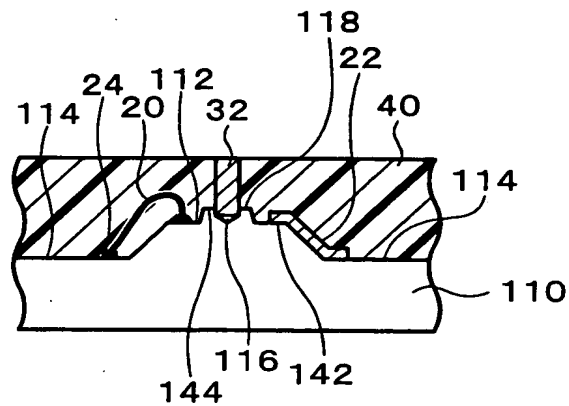
【図 1 3】



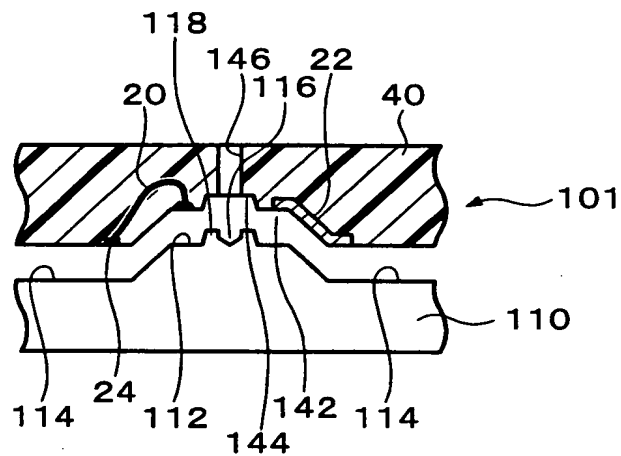
【図 1 4】



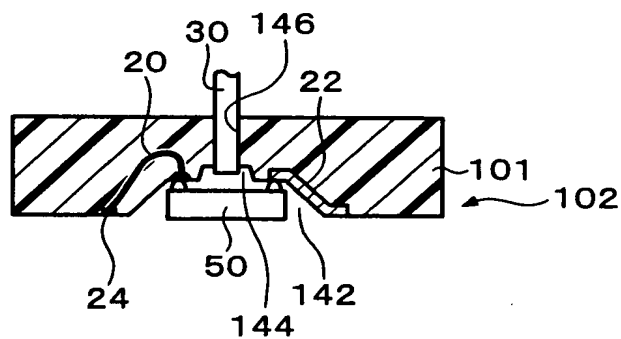
【図 15】



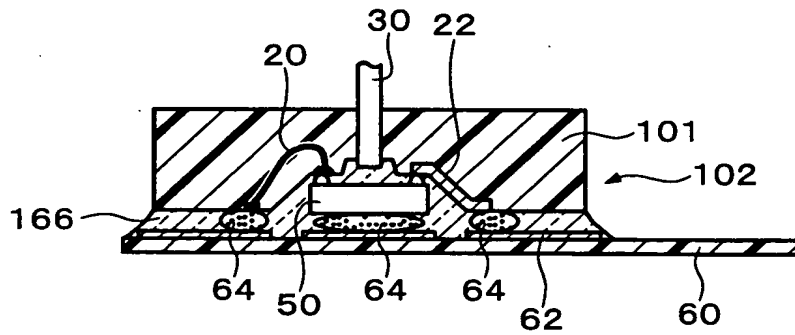
【図 16】



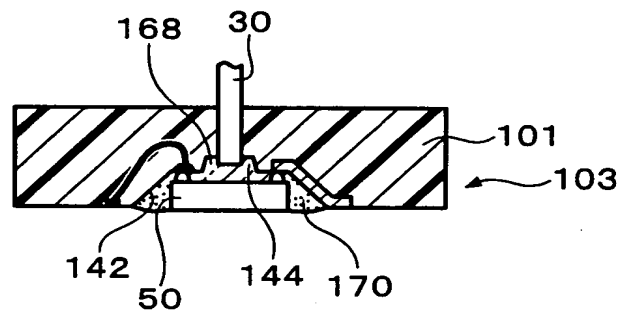
【図 17】



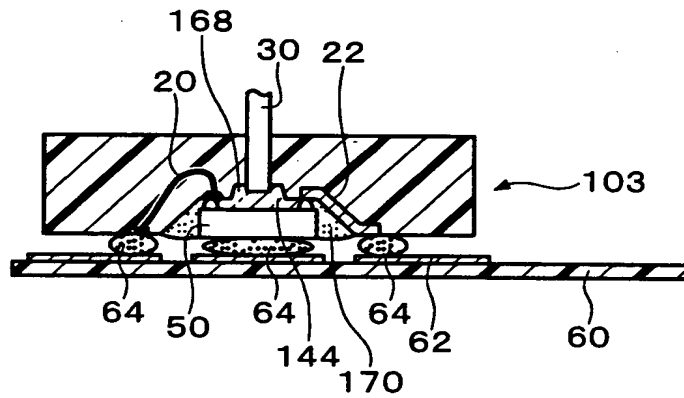
【図 18】



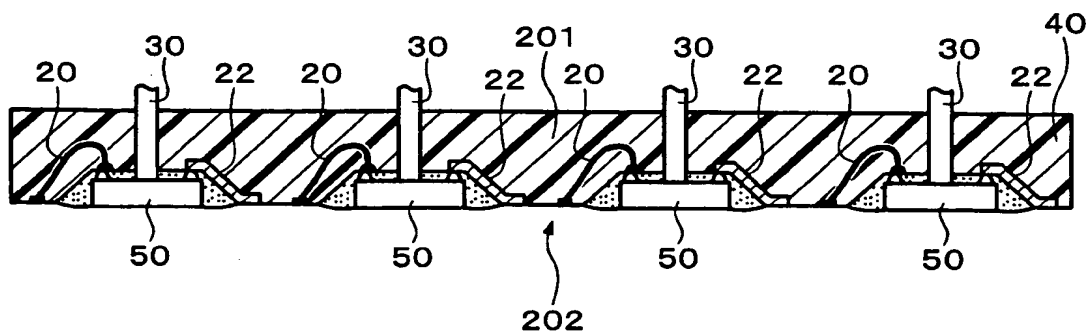
【図 19】



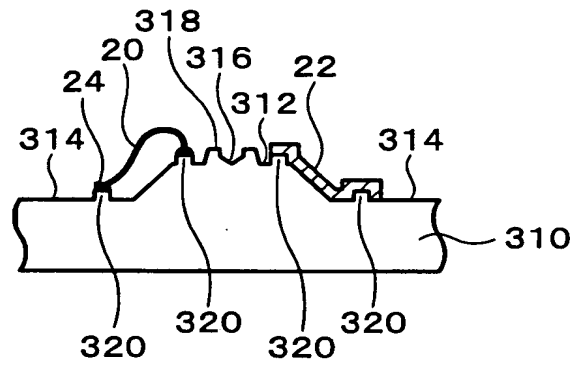
【図 20】



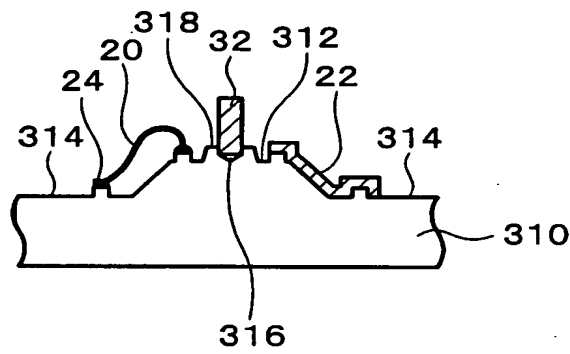
【図 21】



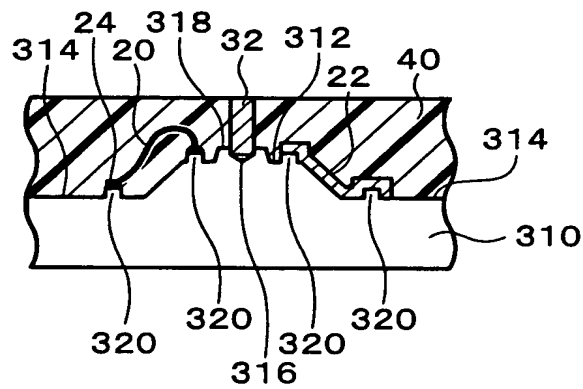
【図 2 2】



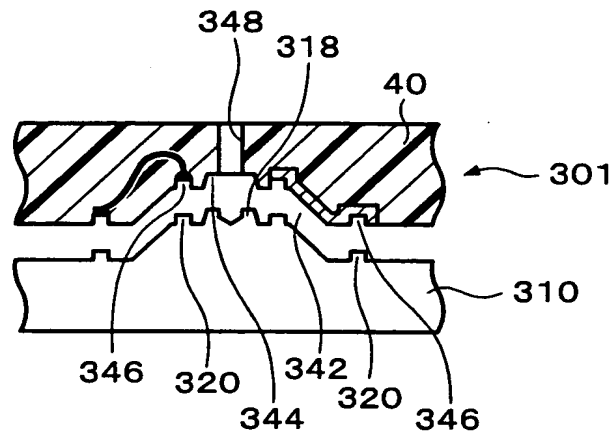
【図 2 3】



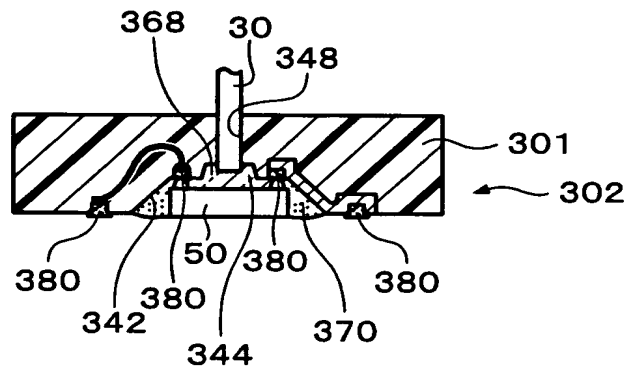
【図 2 4】



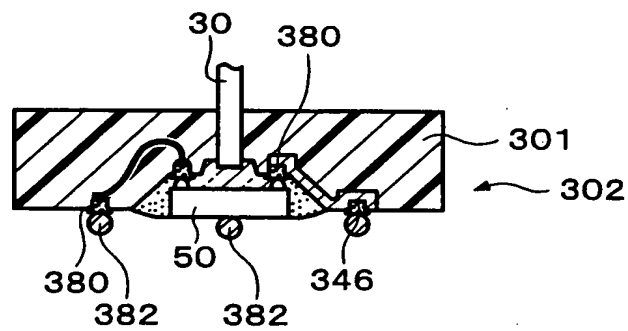
【図 25】



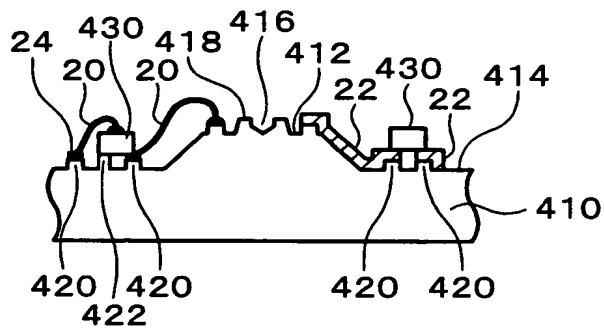
【図 26】



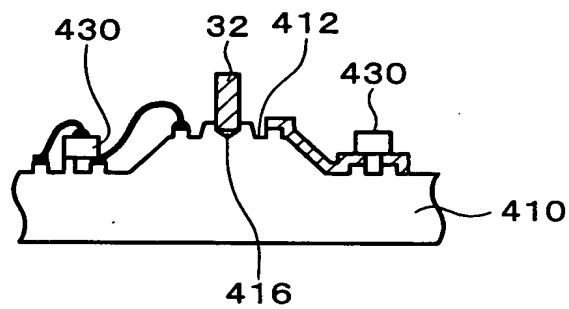
【図 27】



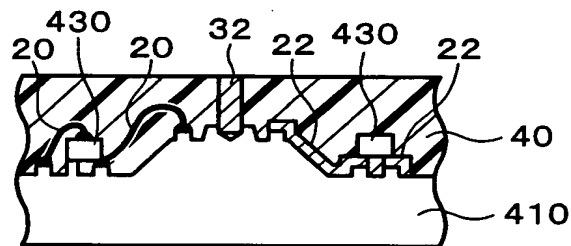
【図 28】



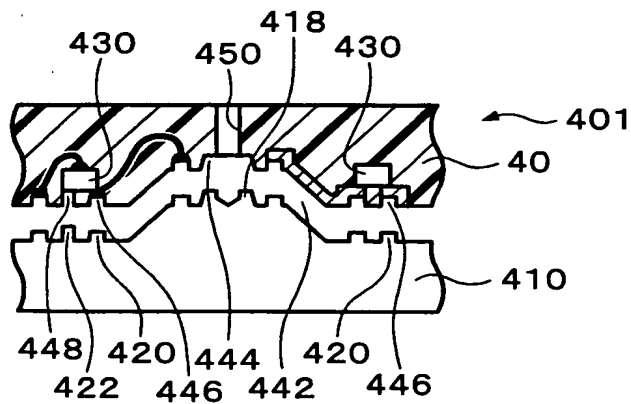
【図 29】



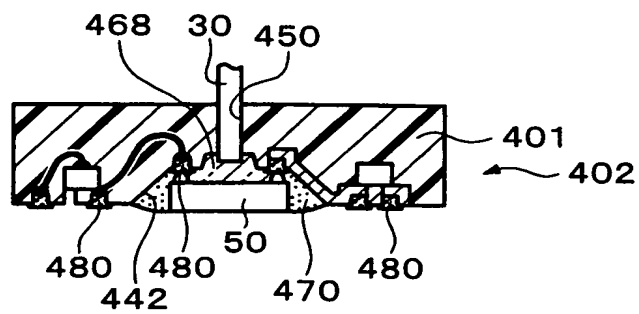
【図 30】



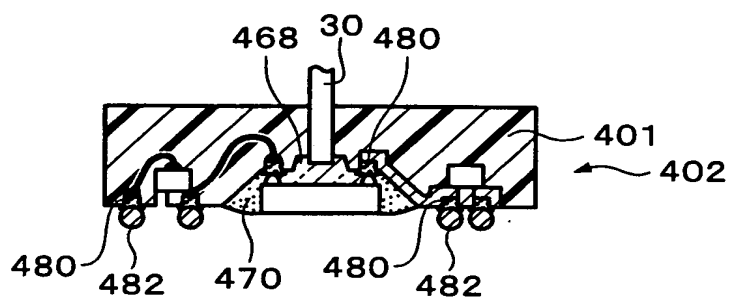
【図 31】



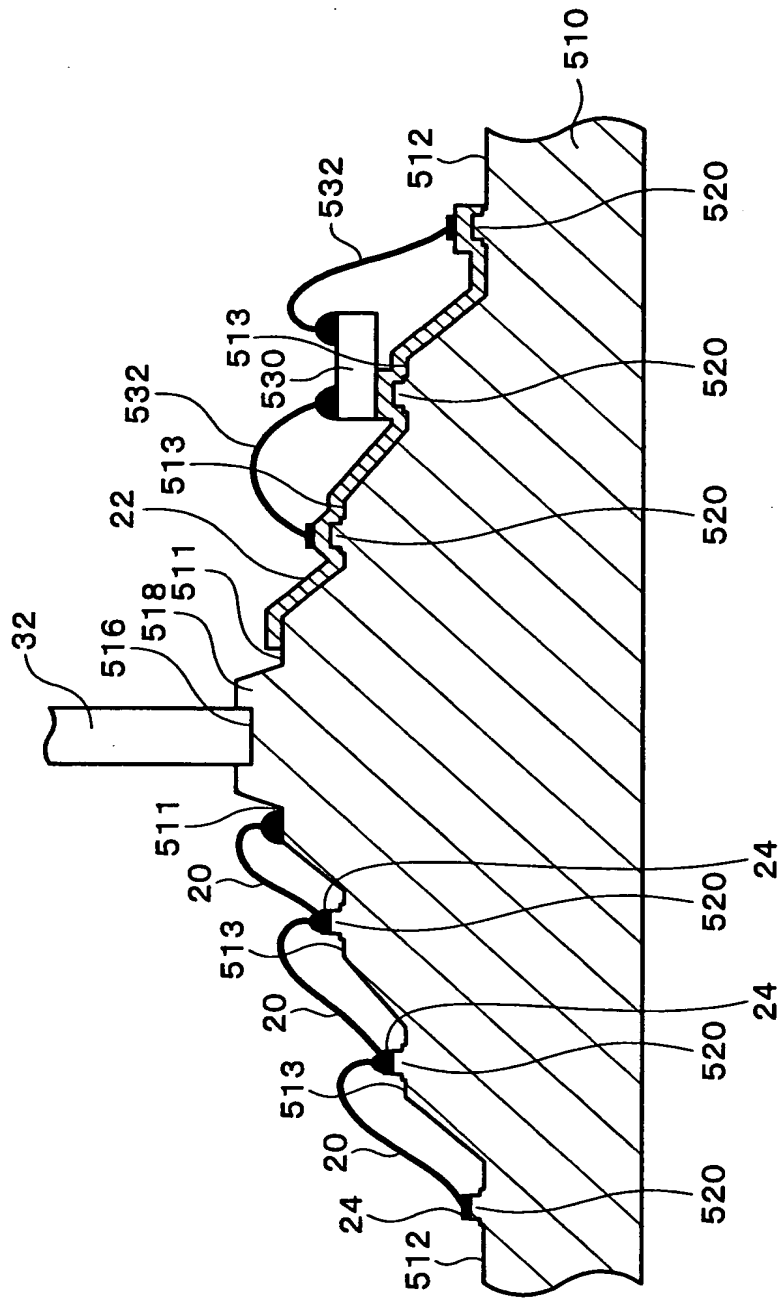
【図 3 2】



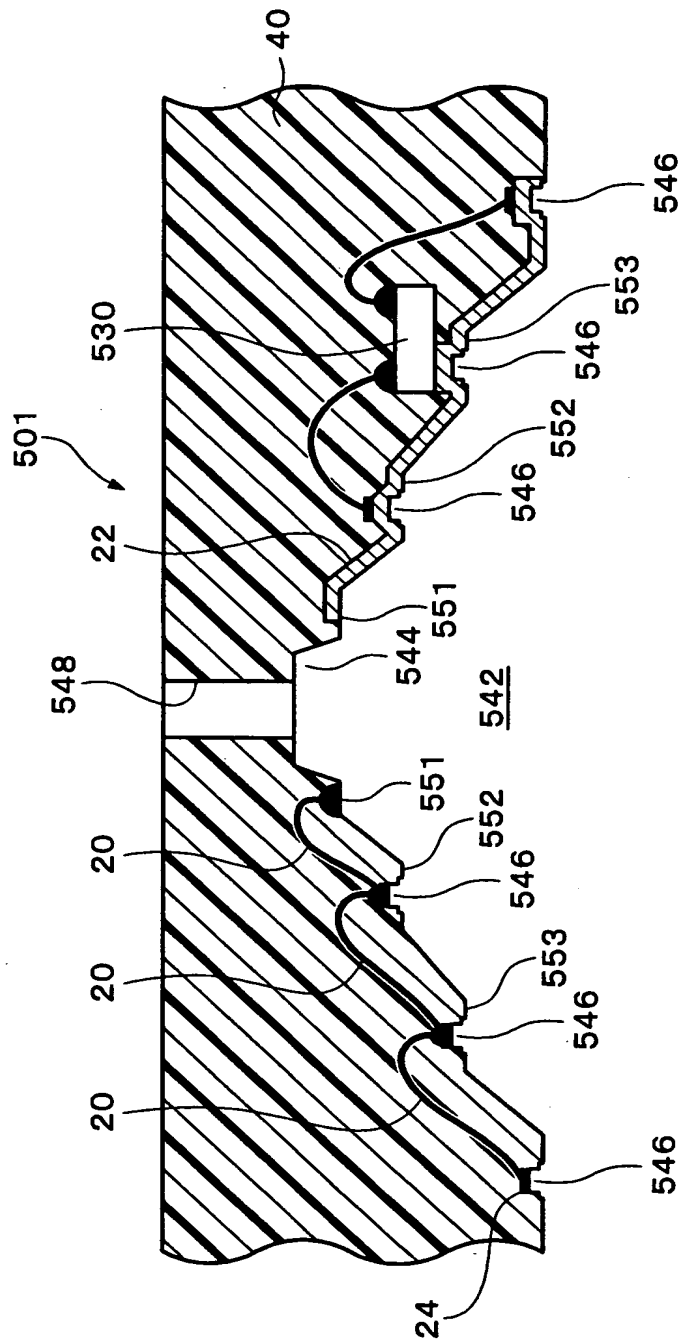
【図 3 3】



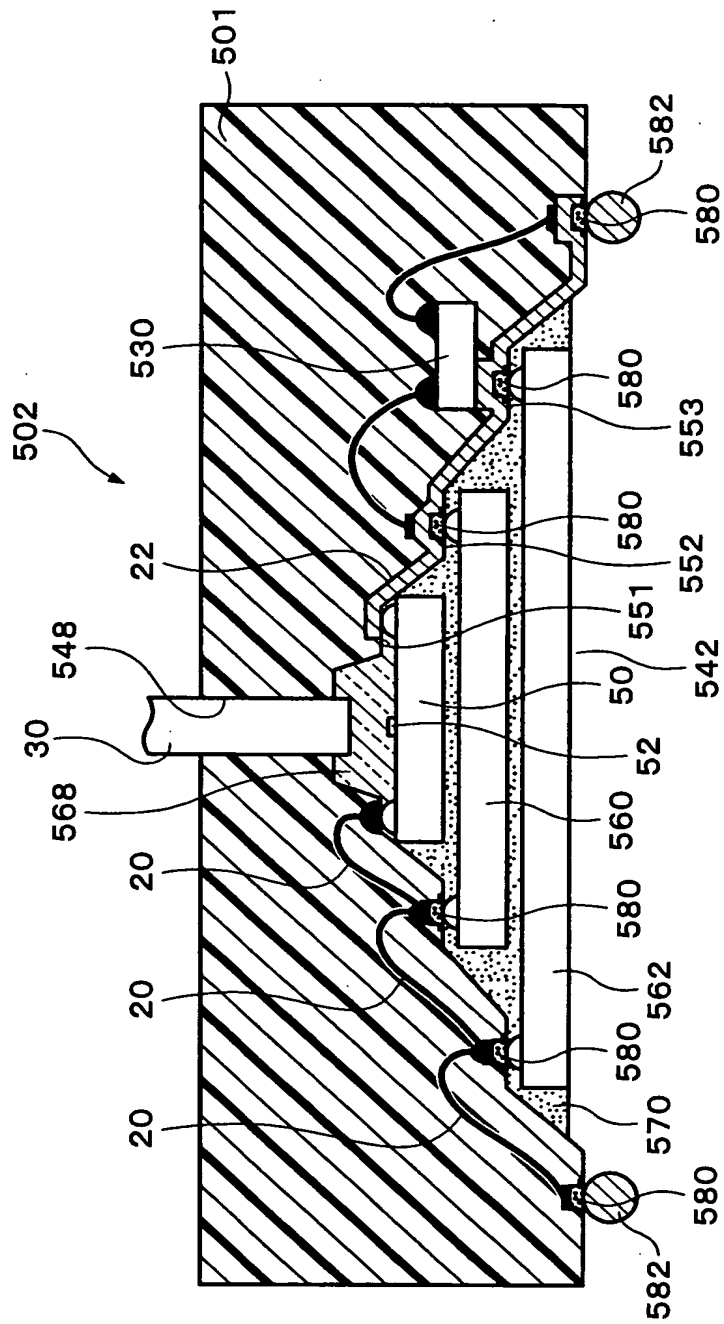
【図 34】



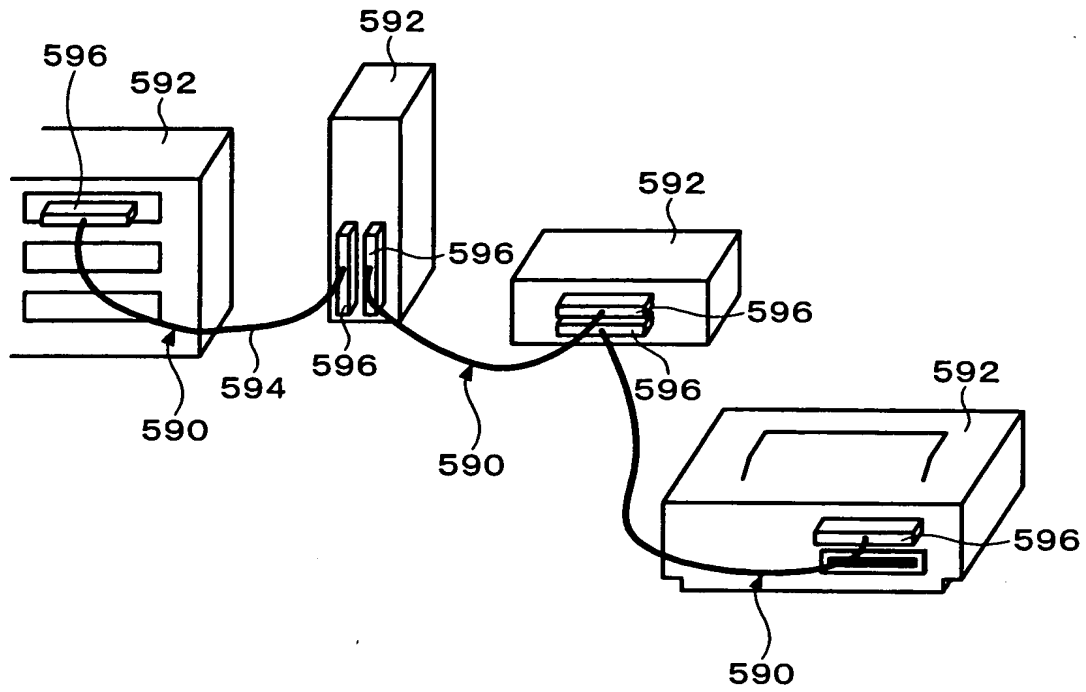
【図 35】



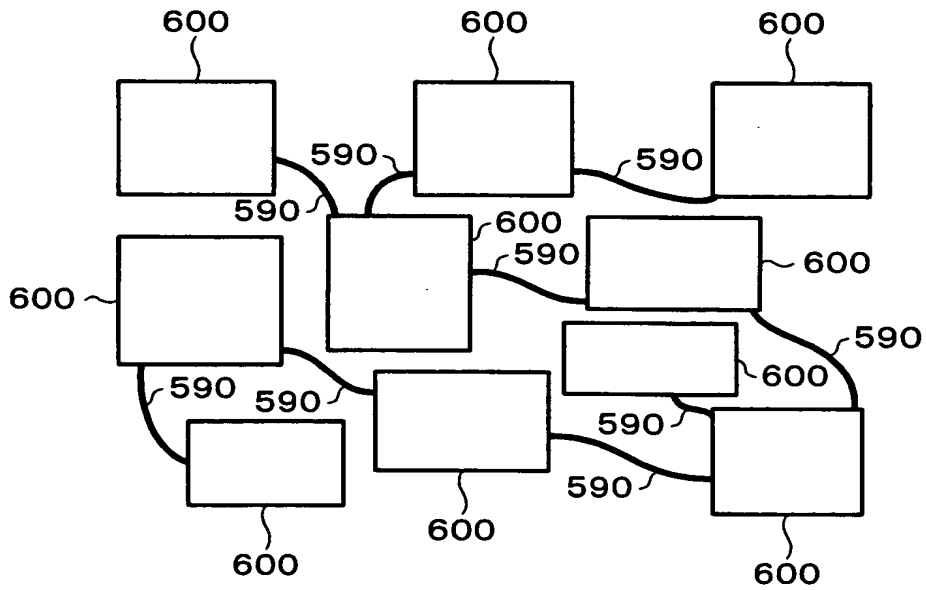
【図 36】



【図 37】



【図 38】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 配線による凸が形成されないプラットフォーム及び光モジュール並びにこれらの製造方法並びに光伝達装置を提供することにある。

【解決手段】 プラットフォームの製造方法は、型 1 0 の第 1 及び第 2 の領域 1 2、1 4 に、配線 2 0、2 2 を付着させて設け、ピン 3 2 を、その先端部を型 1 0 に向けて配置し、成形材料 4 0 でピン 3 2 及び配線 2 0、2 2 を封止し、成形材料 4 0 を硬化させ、ピン 3 2 を成形材料 4 0 から抜いて貫通穴 4 4 を形成し、配線 2 0、2 2 とともに成形材料 4 0 を、型 1 0 から剥離する工程を含む。

【選択図】 図 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名 セイコーエプソン株式会社